

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Mechanical structures for electronic equipment – Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series –

Part 3-107: Dimensions of subracks and plug-in units, small form factor

Structures mécaniques pour équipements électroniques – Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces) –

Partie 3-107: Dimensions des bacs et blocs enfichables de petit facteur de forme





THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2012 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

Useful links:

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables you to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...).

It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available on-line and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) on-line.

Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Liens utiles:

Recherche de publications CEI - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée vous permet de trouver des publications CEI en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...).

Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

Just Published CEI - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) en ligne.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.



IEC 60297-3-107

Edition 1.0 2012-01

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Mechanical structures for electronic equipment – Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series –

Part 3-107: Dimensions of subracks and plug-in units, small form factor

Structures mécaniques pour équipements électroniques – Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces) –

Partie 3-107: Dimensions des bacs et blocs enfichables de petit facteur de forme

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX



ICS 31.240

ISBN 978-2-88912-844-0

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

CONTENTS

FOREWORD.....	4
INTRODUCTION.....	6
1 Scope and object.....	7
2 Normative references	7
3 Arrangement overview (4U shown)	8
4 Subrack dimensions	9
4.1 Subrack dimensions front mounting area.....	9
4.2 Subrack dimensions, rear view, backplane mounting area.....	12
5 Plug-in unit dimensions	13
6 Connector and related printed board dimensions	14
6.1 Connector according to PICMG-MicroTCA.0/ IEC 61076-4-116, fixed board connector and related printed board dimensions.....	14
6.1.1 PICMG- MicroTCA.0/ IEC 61076-4-116 connector, isometric view	14
6.1.2 Connector according to PICMG- MicroTCA.0/ IEC 61076-4-116, fixed board connector and related printed board – arrangement overview	14
6.1.3 Printed board dimensions	15
6.1.4 Printed board dimensions, 4U example.....	16
6.1.5 Connector according to PICMG-MTCA.0, fixed board connector dimensions	17
6.2 Two part connector according to IEC 61076-4-116 and related printed board dimensions.....	17
6.2.1 Two part connector, isometric view.....	17
6.2.2 Two part connector, arrangement overview	18
6.2.3 Two part connector, printed board dimensions.....	18
6.2.4 Two part connector, fixed board connector dimensions.....	19
6.3 Two part connector with PIU PB component side attachment features	19
6.3.1 Two part connector, arrangement overview	19
6.3.2 Two part connector, printed circuit board dimensions, 2 U	19
6.3.3 Two part connector, connector mounted on backplane, 2 U	20
7 Backplane dimensions.....	21
7.1 Backplane dimensions using two part connector according to IEC 61076-4-116	21
8 Subrack and plug-in units with electromagnetic shielding (EMC) provisions.....	23
8.1 General	23
8.2 Subrack EMC provisions	23
8.3 Plug-in unit and filler panels EMC provisions	24
9 Subrack and plug in units electrostatic discharge provisions (ESD)	24
9.1 General	24
9.2 Subrack ESD provisions	25
9.3 Plug-in unit ESD provisions, front mounted	26
10 Nomenclature	27
Annex A (informative) Connector hole pattern at the backplane	29
Annex B (informative) Rear mounted plug-in unit implementation.....	30
Annex C (informative) Hot swap latch function	32
Annex D (informative) Subrack latch mechanism interface dimensions for ruggedized applications	33
Annex E (informative) Subrack ESD contact interface dimensions	34

Figure 1 – Arrangement overview	8
Figure 2 – Subrack dimensions, front view	10
Figure 3 – Subrack dimensions, side view	11
Figure 4 – Subrack dimensions, top view	12
Figure 5 – Subrack dimensions, rear view.....	12
Figure 6 – Plug-in unit dimensions	13
Figure 7 – PICMG- MicroTCA.0/ IEC 61076-4-116 connector, isometric view	14
Figure 8 – PICMG- MicroTCA.0/ IEC 61076-4-116 fixed board connector, arrangement overview – Top view	14
Figure 9 – Printed board dimensions.....	15
Figure 10 – Printed board dimensions, 4U example	16
Figure 11 – Connector according to PICMG- MTCA.0, fixed board connector dimensions	17
Figure 12 – Fixed board and free board connector – Isometric view	17
Figure 13 – Two part connector, arrangement overview – Top view	18
Figure 14 – Two part connector, printed board dimensions	18
Figure 15 – Two part connector, arrangement overview – Top view	19
Figure 16 – Two part connector, dimensions, 2 U	19
Figure 17 – Two part connector, connector mounted on backplane dimensions, 2 U	20
Figure 18 – Backplane dimensions.....	22
Figure 19 – Subrack EMC dimensions	23
Figure 20 – Plug-in unit EMC dimensions.....	24
Figure 21 – Subrack ESD provision	25
Figure 22 – Plug-in unit ESD provision.....	26
Figure A.1 – Connector pin location according to IEC 61076-4-116, front view.....	29
Figure B.1 – Depth dimension subrack type 1, side view.....	30
Figure B.2 – Depth dimension subrack type 2, side view.....	30
Figure B.3 – Depth dimension subrack type 3, side view.....	31
Table 1 – Height dimensions.....	26
Table 2 – Depth dimensions.....	27

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT – DIMENSIONS OF MECHANICAL STRUCTURES OF THE 482,6 mm (19 in) SERIES –

Part 3-107: Dimensions of subracks and plug-in units, small form factor

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60297-3-107 has been prepared by subcommittee 48D: Mechanical structures for electronic equipment, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
48D/492/FDIS	48D/501/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of IEC 60297 series, under the general title *Mechanical structures for electronic equipment – Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

This standard provides for an alternative/smaller form factor of plug-in units as defined in IEC 60297-3-101.

New technologies requiring smaller plug-in unit form factors used in 19 in equipment practice are rapidly gaining acceptance.

Recognizing this development it became obvious that a generic interface standard would be an advantage to the industry.

This standard is based upon and coordinated with the plug-in unit form factor as defined in AMC.0 and MicroTCA developed by PICMG (PCI Industrial Computers Manufacturer Group).

By making critical interface dimensions available and permitting the use of alternative connectors to the industry (beyond AMC.0 and MicroTCA) multiple product solutions may make use of this technology and will increase the overall market acceptance, increase availability, and reduce cost.

In order to meet the requirements of small form factor plug-in units within the subrack the interface dimensions required differ from IEC 60297-3-101. This standard defines these small form factor interface dimensions.

The small form factor generic dimensions are based on and coordinated with AMC.0 and MicroTCA.

Since the AMC.0 and MicroTCA Specification defines only a limited range of connectors this standard opens the possible use of other suitable connectors.

MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT – DIMENSIONS OF MECHANICAL STRUCTURES OF THE 482,6 mm (19 in) SERIES –

Part 3-107: Dimensions of subracks and plug-in units, small form factor

1 Scope and object

This part of IEC 60297 defines the interface dimensions between subracks and associated plug-in units using connectors as defined in PICMG-MTCA.0 (Fixed board, see Figure 7) and IEC 61076-4-116 (Two part, see Figure 12) and other two part connectors, (see Figure 15).

For mechanical and climatic tests refer to IEC 61587-1.

For electromagnetic shielding performance tests refer to IEC 61587-3.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60297-3-100: *Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series – Part 3-100: Basic dimensions of front panels, subracks, chassis, racks and cabinets*

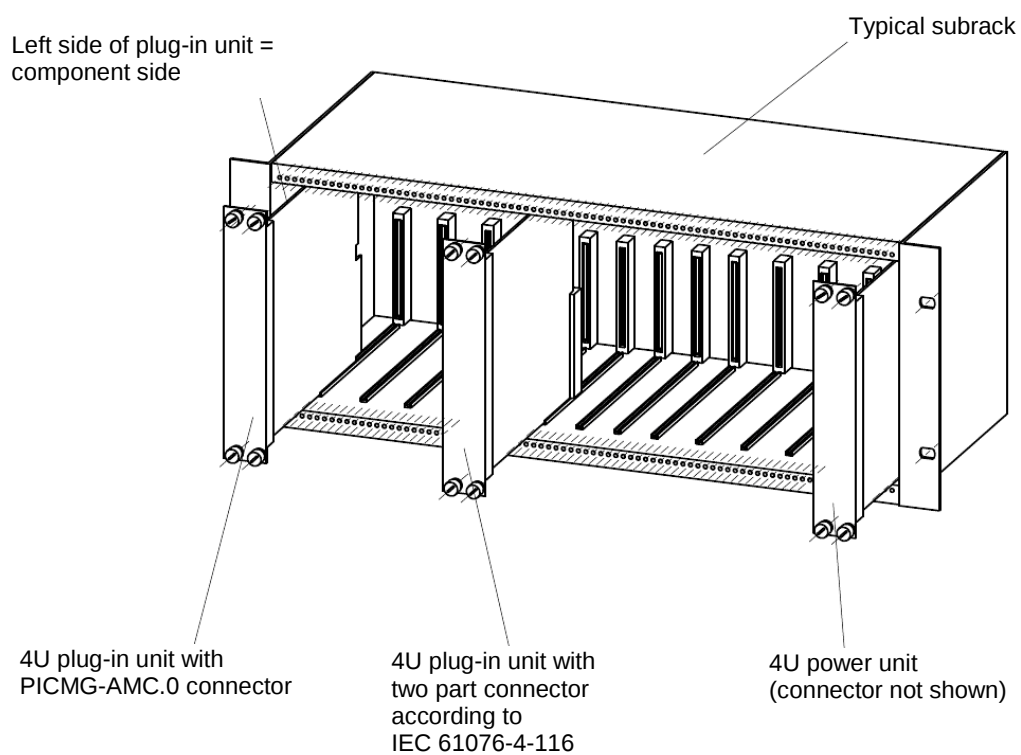
IEC 61076-4-116: *Connectors for electronic equipment – Product requirements – Printed board connectors: Detail specification for a high-speed two-part connector with integrated shielding function* (to be published)

PICMG AMC.0: *Advanced Mezzanine Card Specification*

PICMG MicroTCA.0: *Micro Telecommunications Computing Architecture*

PICMG MicroTCA.1: *Air Cooled Rugged MicroTCA Specification*

3 Arrangement overview (4U shown)



IEC 2770/11

Figure 1 – Arrangement overview

4 Subrack dimensions

4.1 Subrack dimensions front mounting area

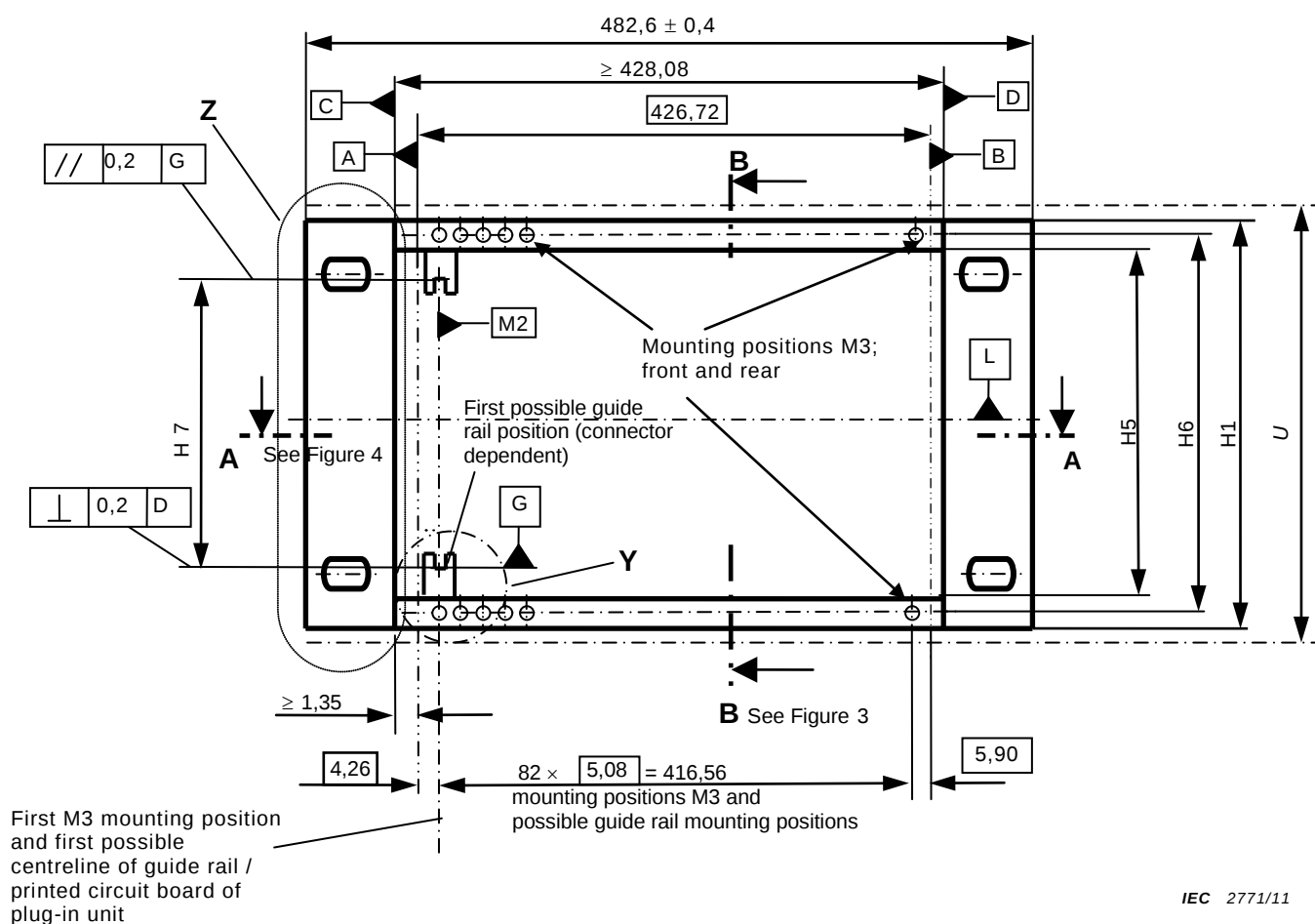


Figure 2a - Front area dimensions

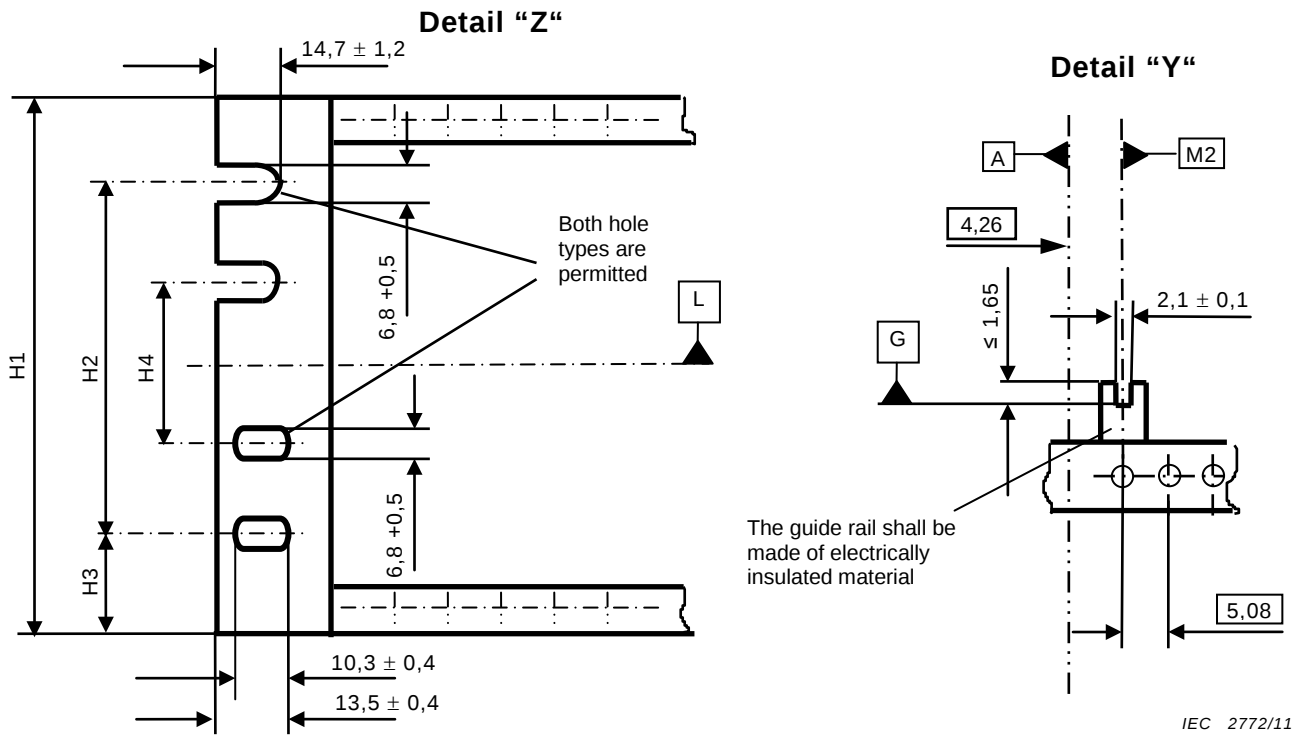


Figure 2b – Mounting holes and guide rail dimensions

Figure 2 – Subrack dimensions, front view

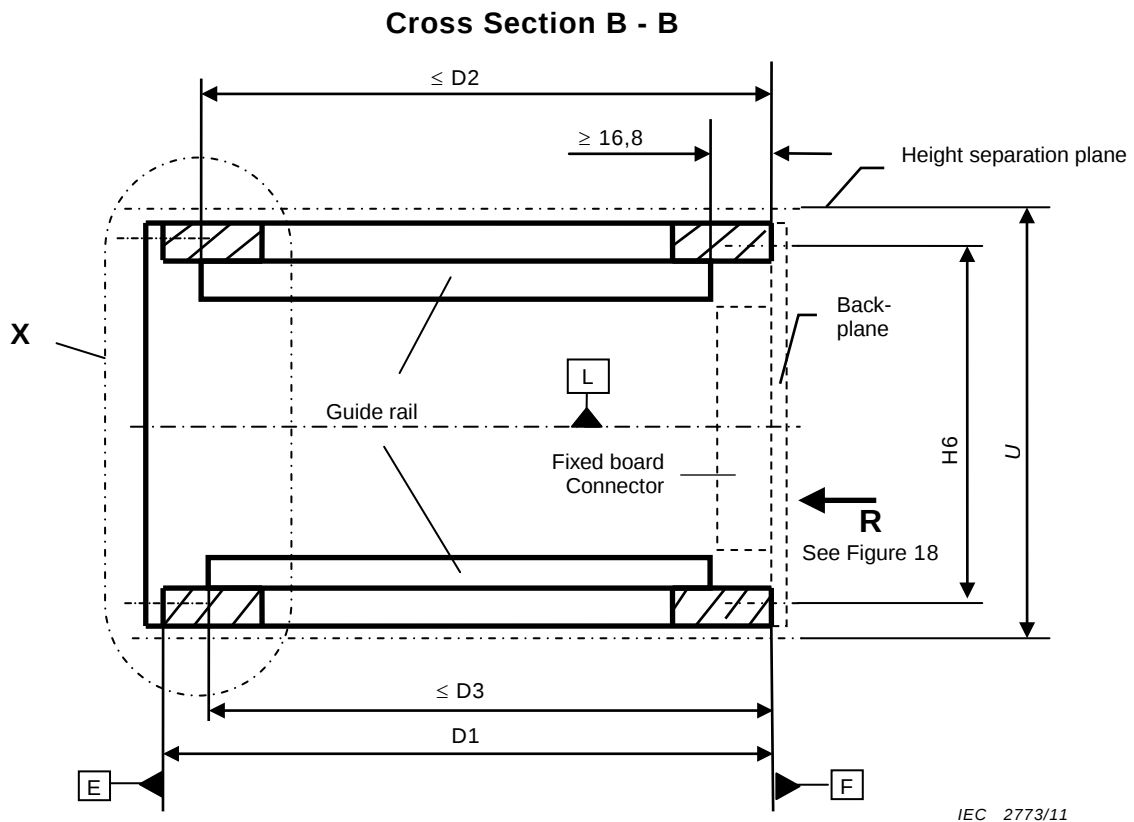


Figure 3a – Guide rail dimensions

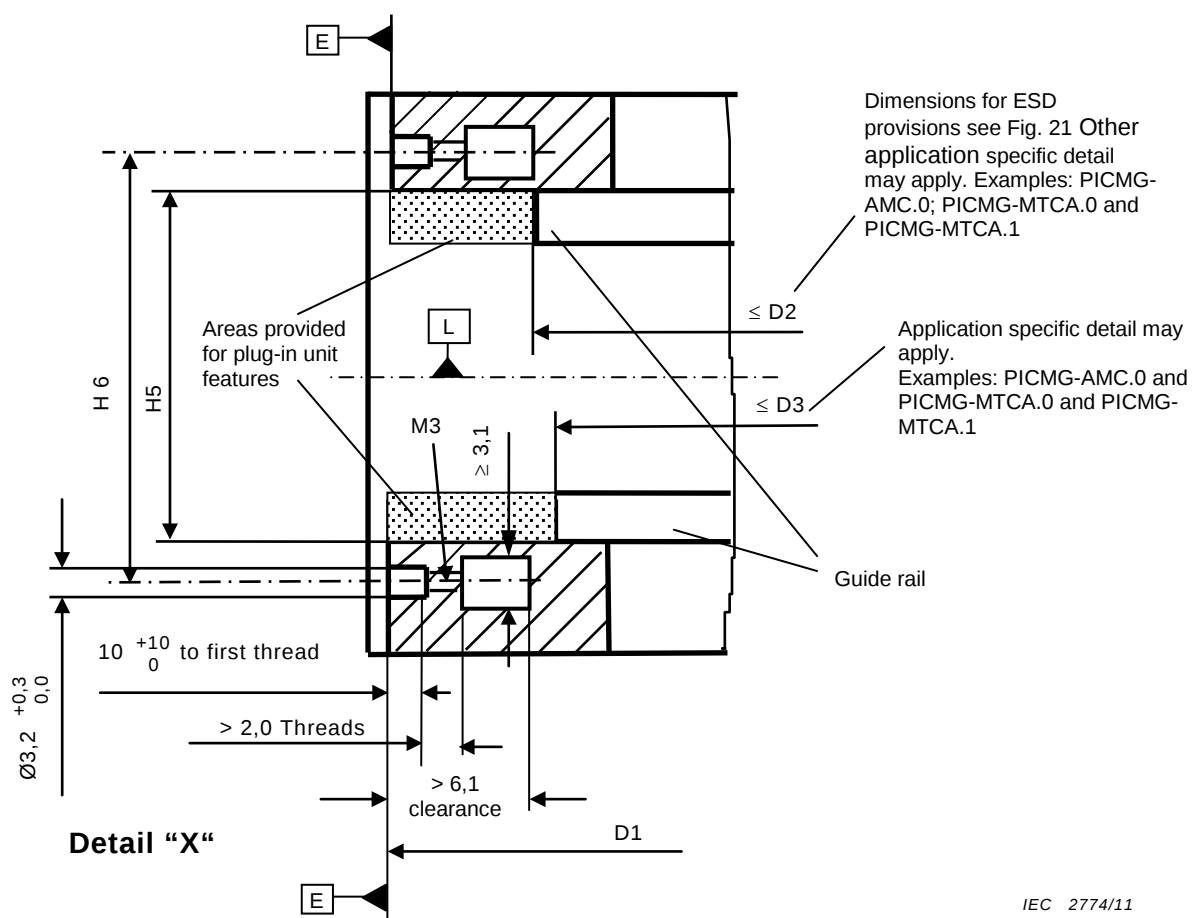


Figure 3b – Mounting hole dimensions

Figure 3 – Subrack dimensions, side view

IEC 2774/11

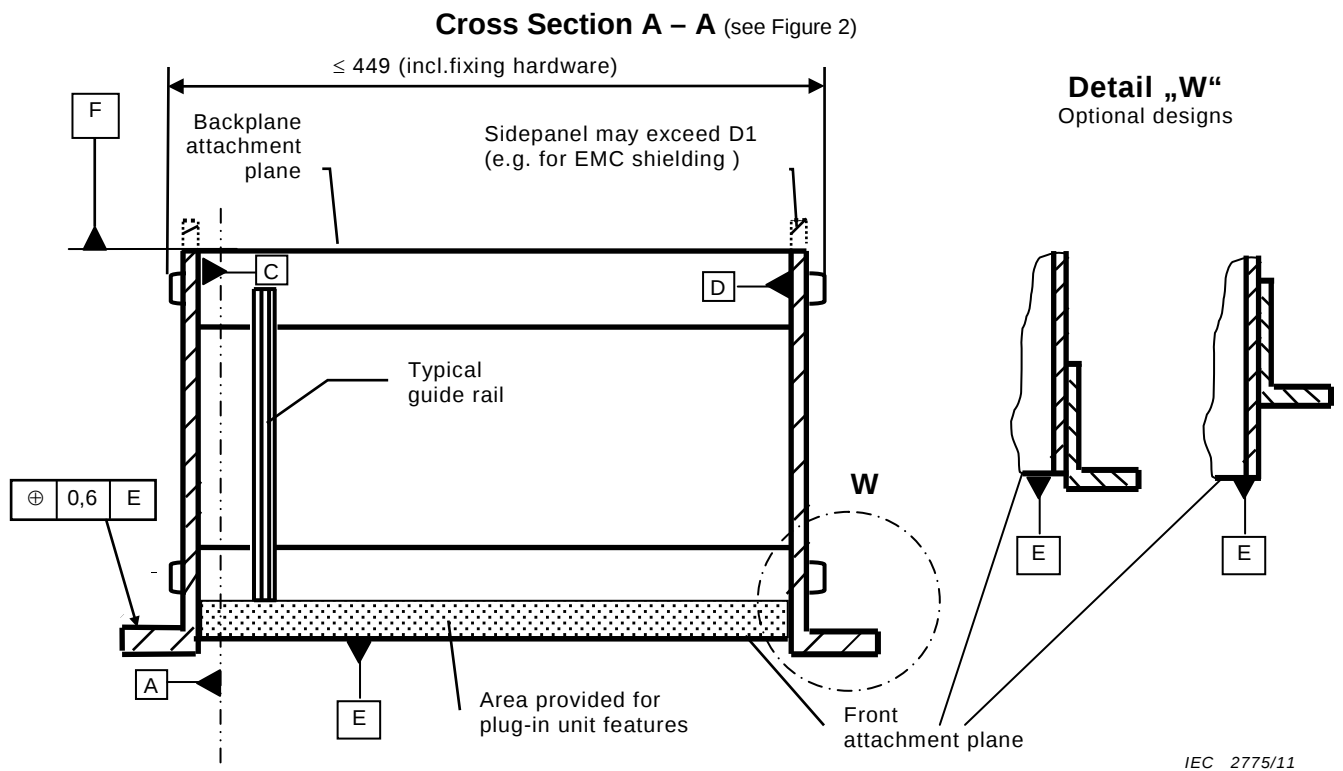


Figure 4 – Subrack dimensions, top view

4.2 Subrack dimensions, rear view, backplane mounting area

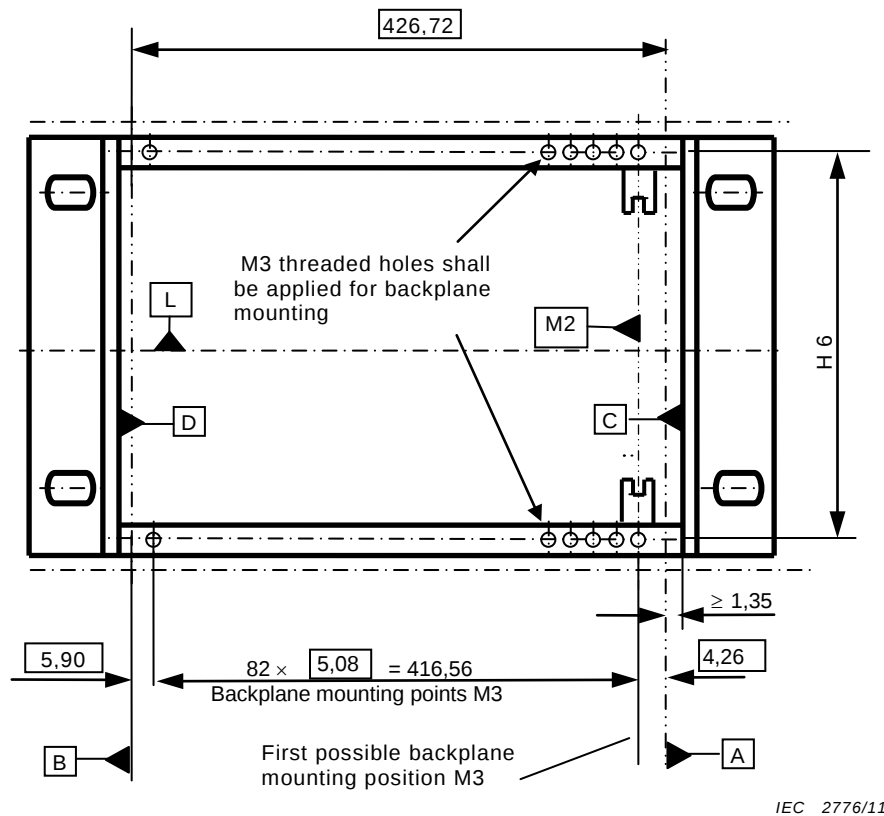


Figure 5 – Subrack dimensions, rear view

5 Plug-in unit dimensions

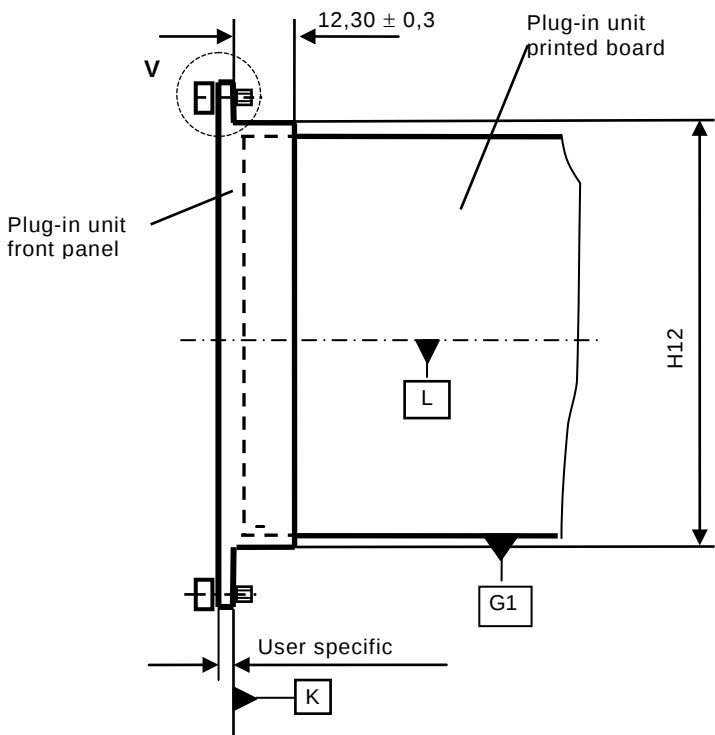
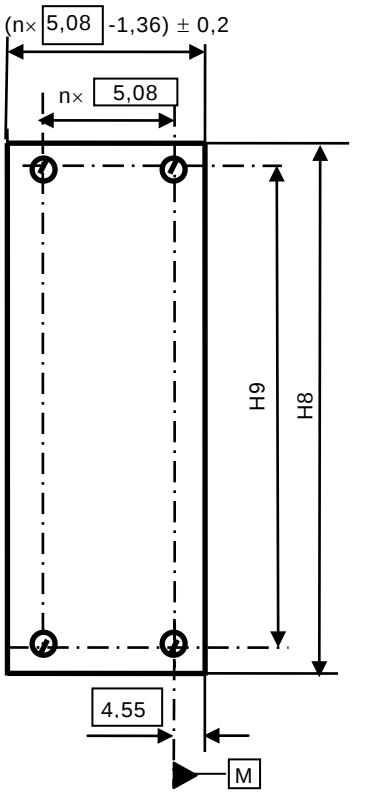


Figure 6a – Front panel dimensions



IEC 2777/11

Detail „V“

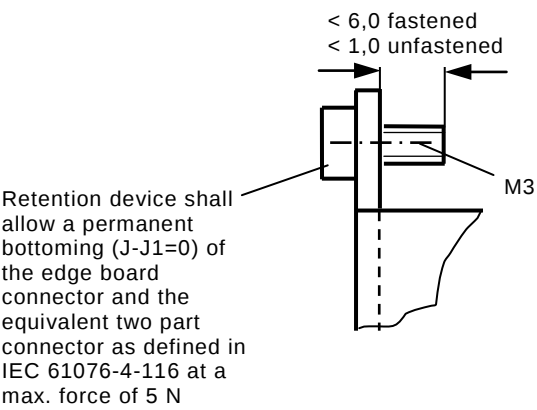
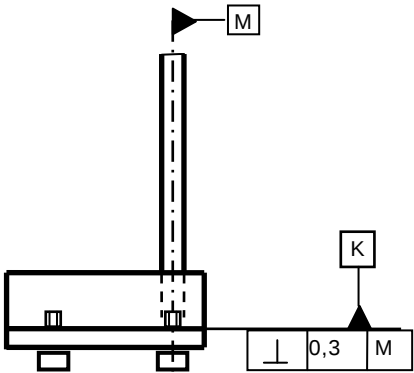


Figure 6b – Retention device dimensions



IEC 2778/11

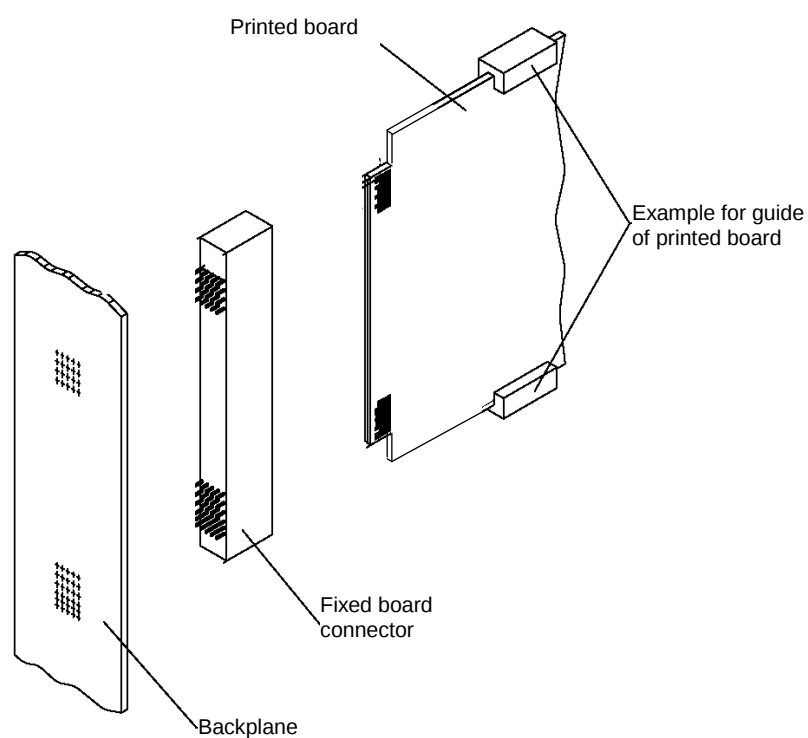
Figure 6 – Plug-in unit dimensions

6 Connector and related printed board dimensions

NOTE The MTCA.0 fixed board connectors is identical with the fixed board connector of IEC 61076-4-116.

6.1 Connector according to PICMG-MicroTCA.0/ IEC 61076-4-116, fixed board connector and related printed board dimensions

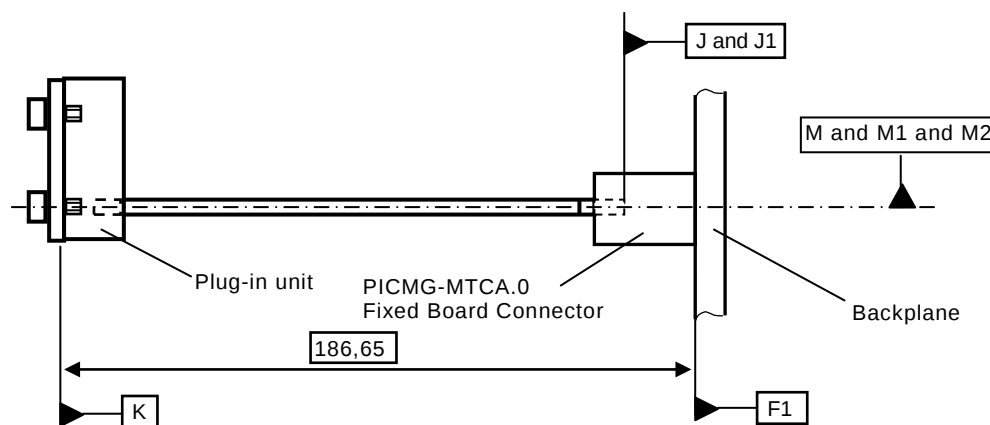
6.1.1 PICMG- MicroTCA.0/ IEC 61076-4-116 connector, isometric view



IEC 2779/11

Figure 7 – PICMG- MicroTCA.0/ IEC 61076-4-116 connector, isometric view

6.1.2 Connector according to PICMG- MicroTCA.0/ IEC 61076-4-116, fixed board connector and related printed board – arrangement overview



IEC 2780/11

Figure 8 – PICMG- MicroTCA.0/ IEC 61076-4-116 fixed board connector, arrangement overview – Top view

6.1.3 Printed board dimensions

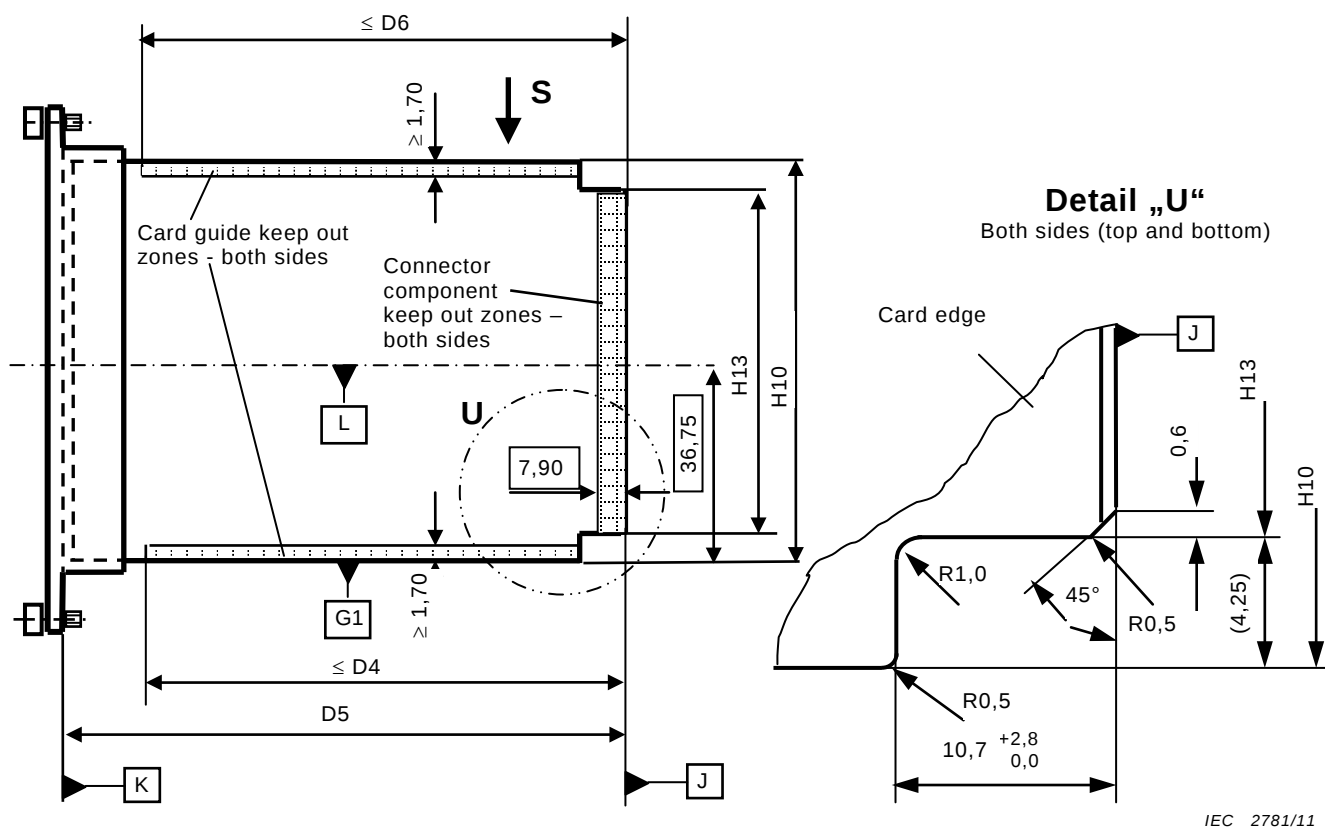


Figure 9a – Printed board dimensions, side view

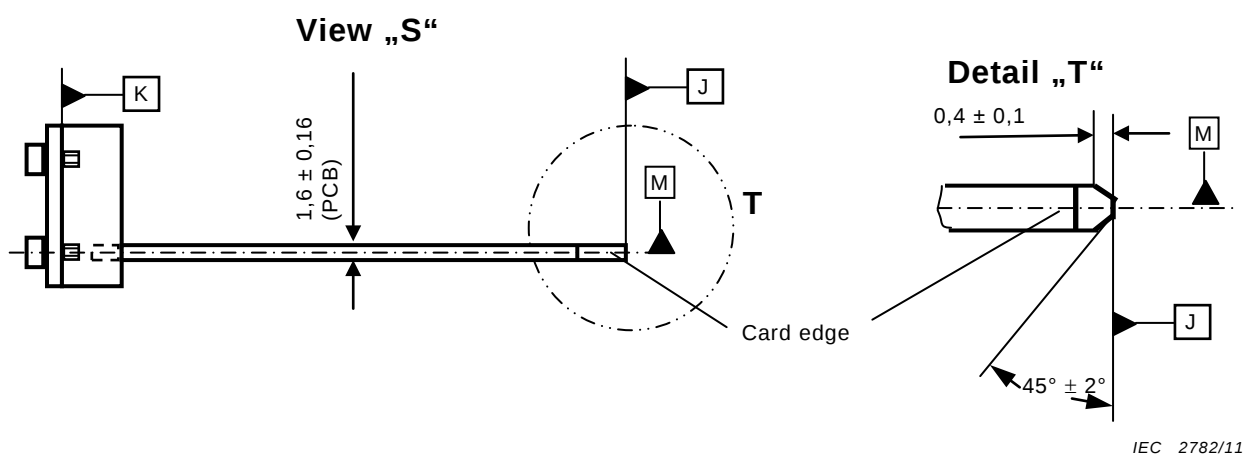


Figure 9b – Printed board dimensions, top view

Figure 9 – Printed board dimensions

6.1.4 Printed board dimensions, 4U example

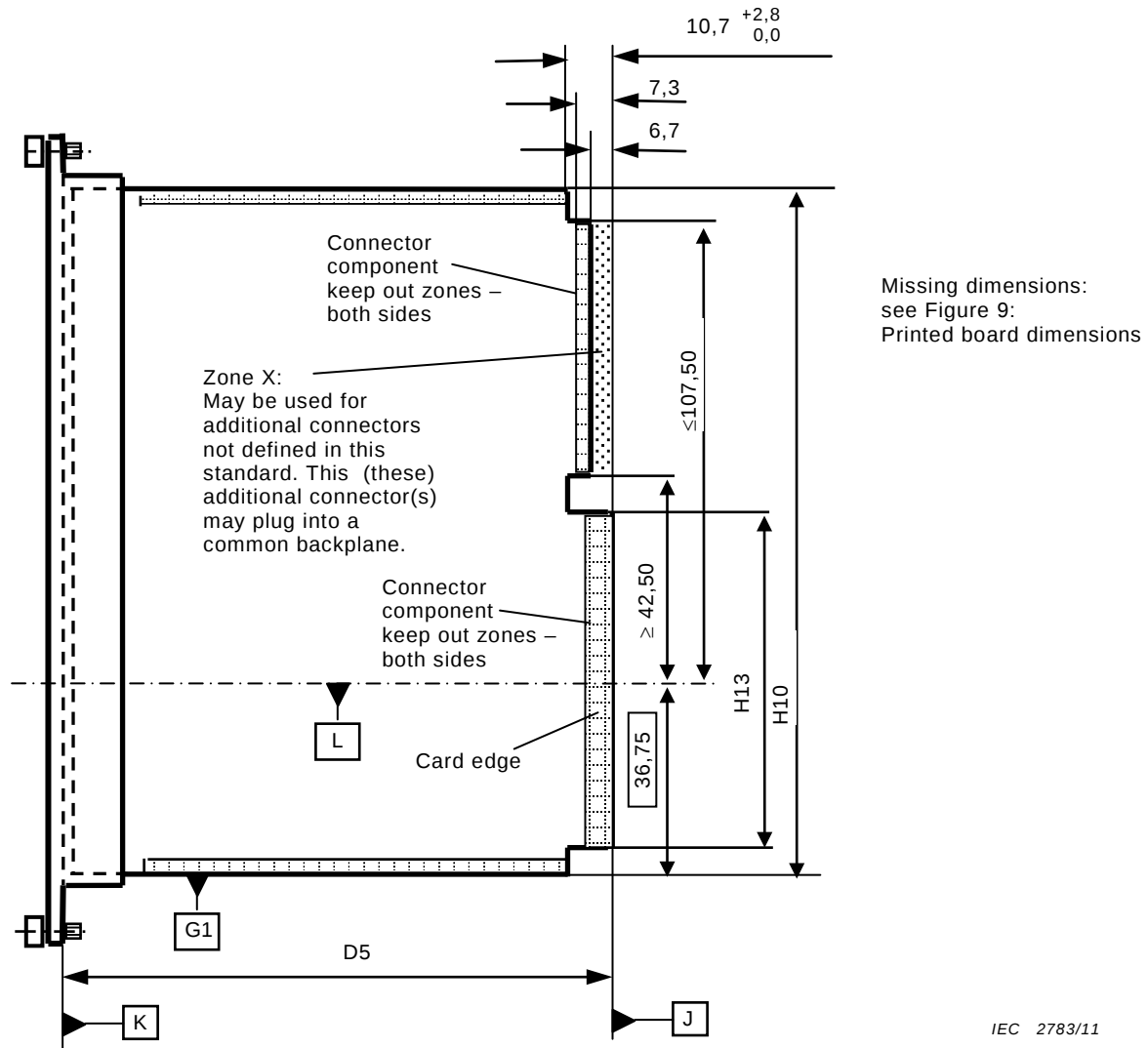


Figure 10 – Printed board dimensions, 4U example

6.1.5 Connector according to PICMG-MTCA.0, fixed board connector dimensions

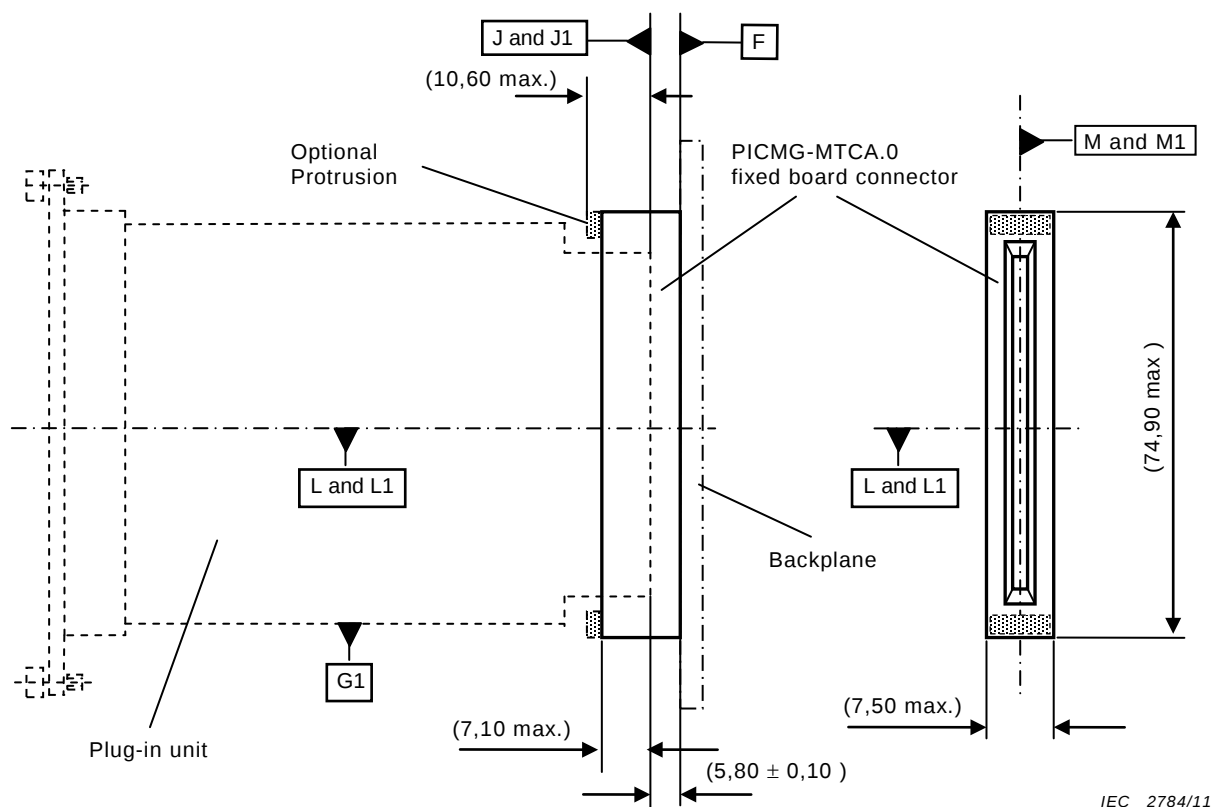


Figure 11 – Connector according to PICMG- MTCA.0, fixed board connector dimensions

6.2 Two part connector according to IEC 61076-4-116 and related printed board dimensions

6.2.1 Two part connector, isometric view

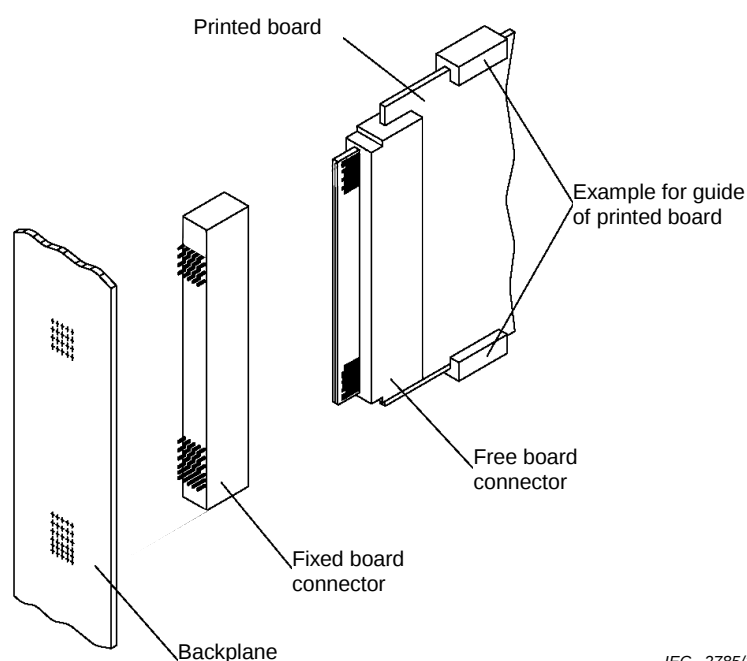


Figure 12 – Fixed board and free board connector – Isometric view

6.2.2 Two part connector, arrangement overview

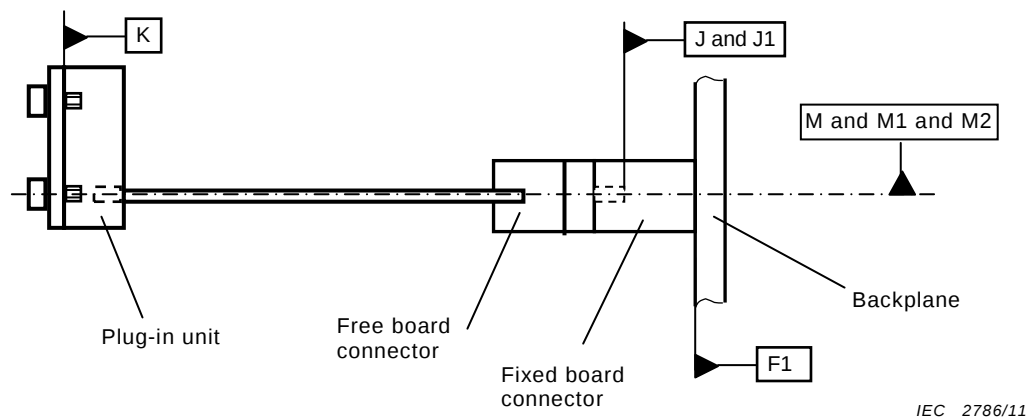


Figure 13 – Two part connector, arrangement overview – Top view

6.2.3 Two part connector, printed board dimensions

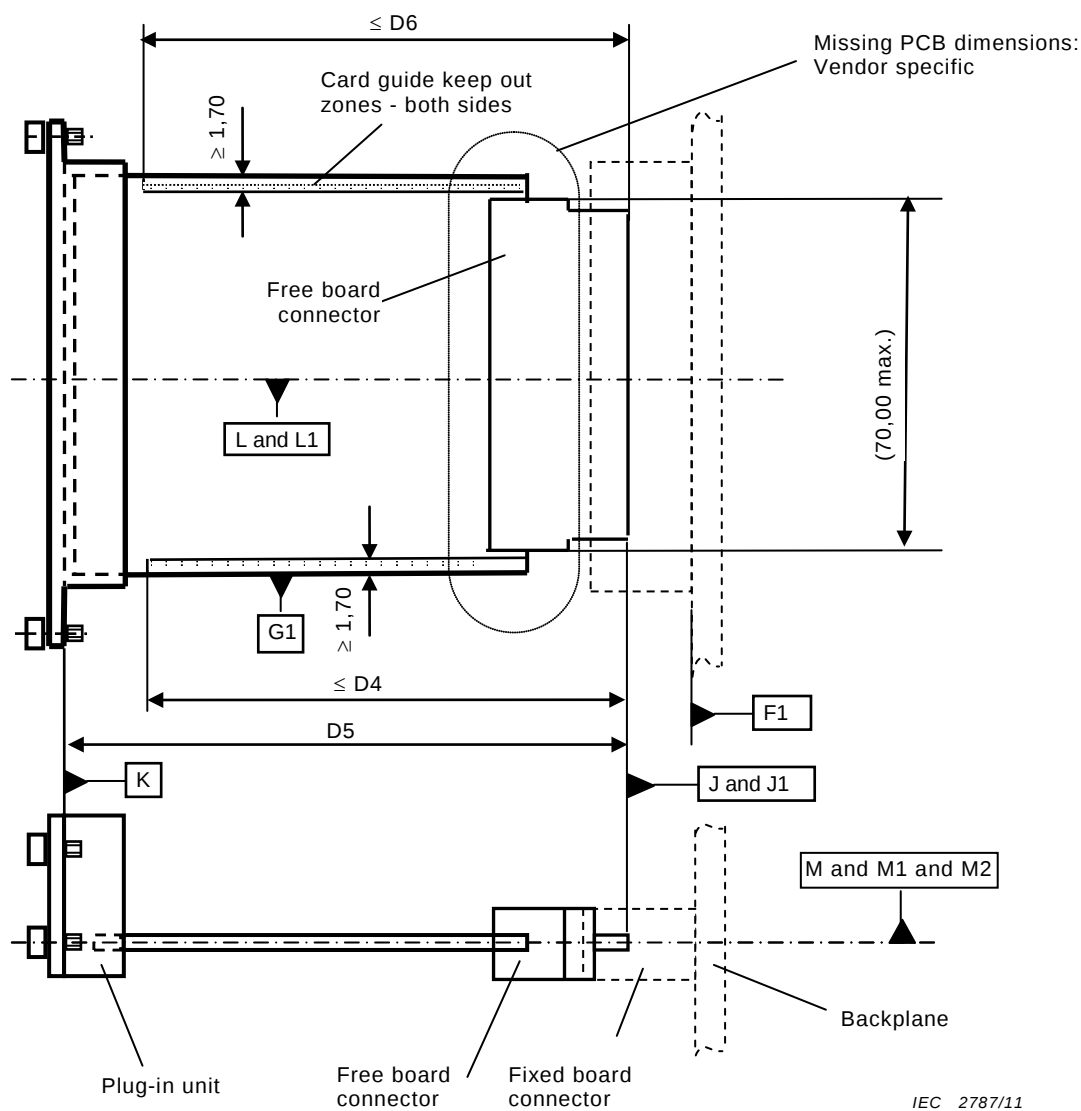


Figure 14 – Two part connector, printed board dimensions

6.2.4 Two part connector, fixed board connector dimensions

See 6.1.5: Fixed board connector dimensions

6.3 Two part connector with PIU PB component side attachment features

NOTE Connectors typically attached to a PIU PB on one of the outer component surfaces are based on a PB thickness of 1,6 mm nominal for the purpose of this standard. See Figure 15.

6.3.1 Two part connector, arrangement overview

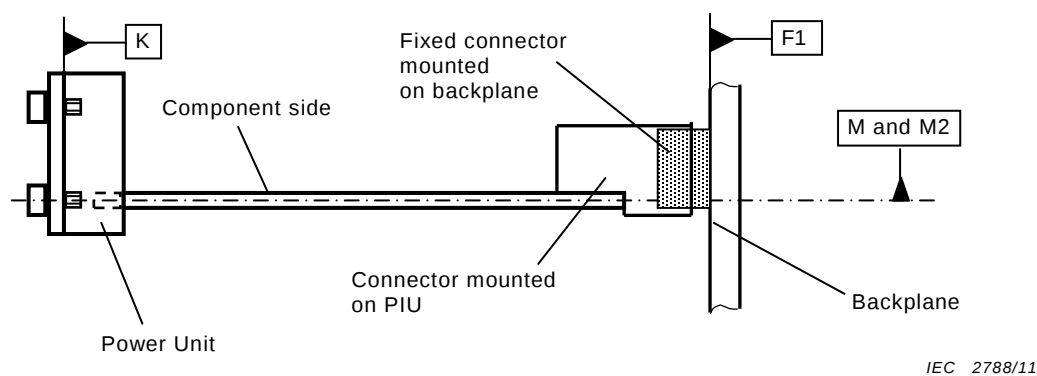


Figure 15 – Two part connector, arrangement overview – Top view

6.3.2 Two part connector, printed circuit board dimensions, 2 U

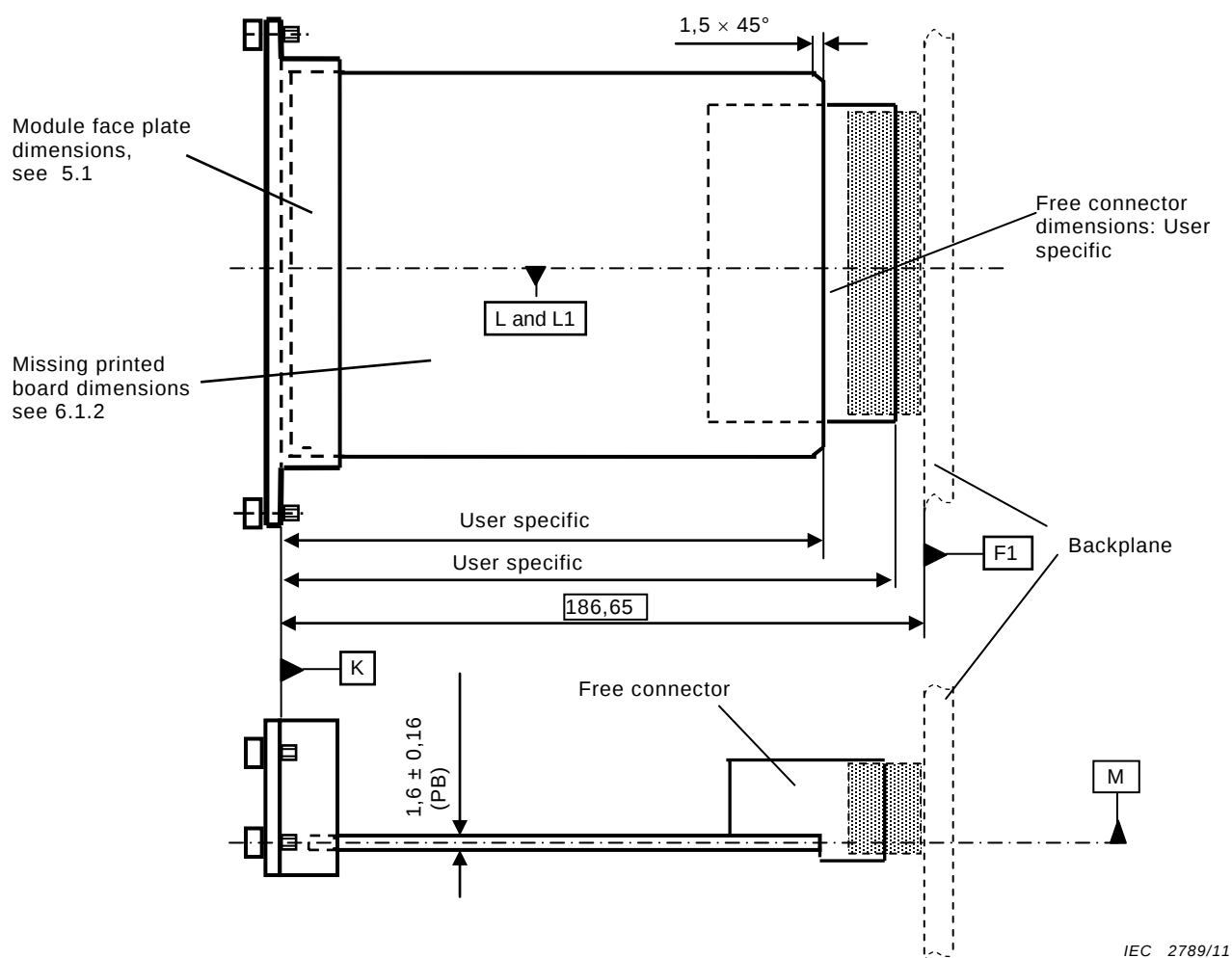


Figure 16 – Two part connector, dimensions, 2 U

6.3.3 Two part connector, connector mounted on backplane, 2 U

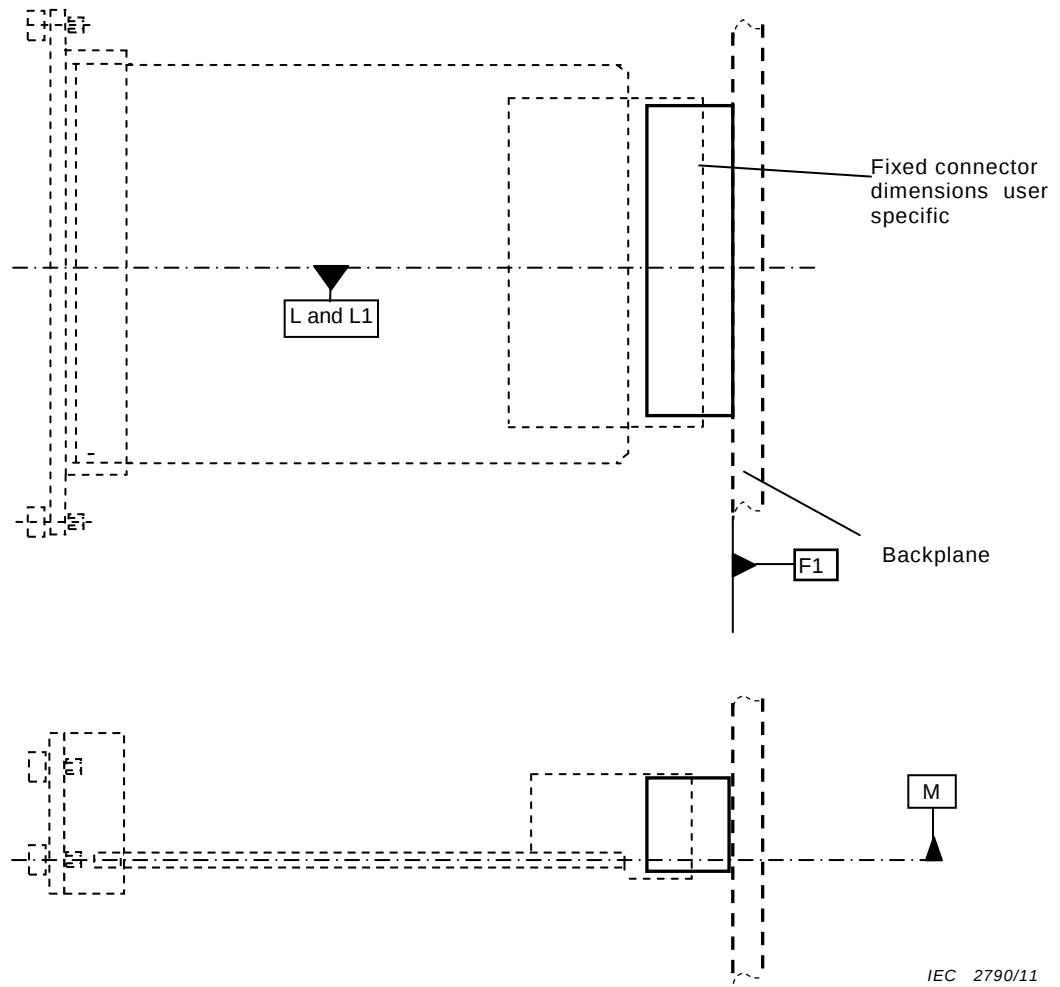


Figure 17 – Two part connector, connector mounted on backplane dimensions, 2 U

7 Backplane dimensions

7.1 Backplane dimensions using two part connector according to IEC 61076-4-116

Figure 18 illustrates the backplane heights and width dimensions as well as the first connector position, using two part connector according to IEC 61076-4-116.

View R (see Figure 3)

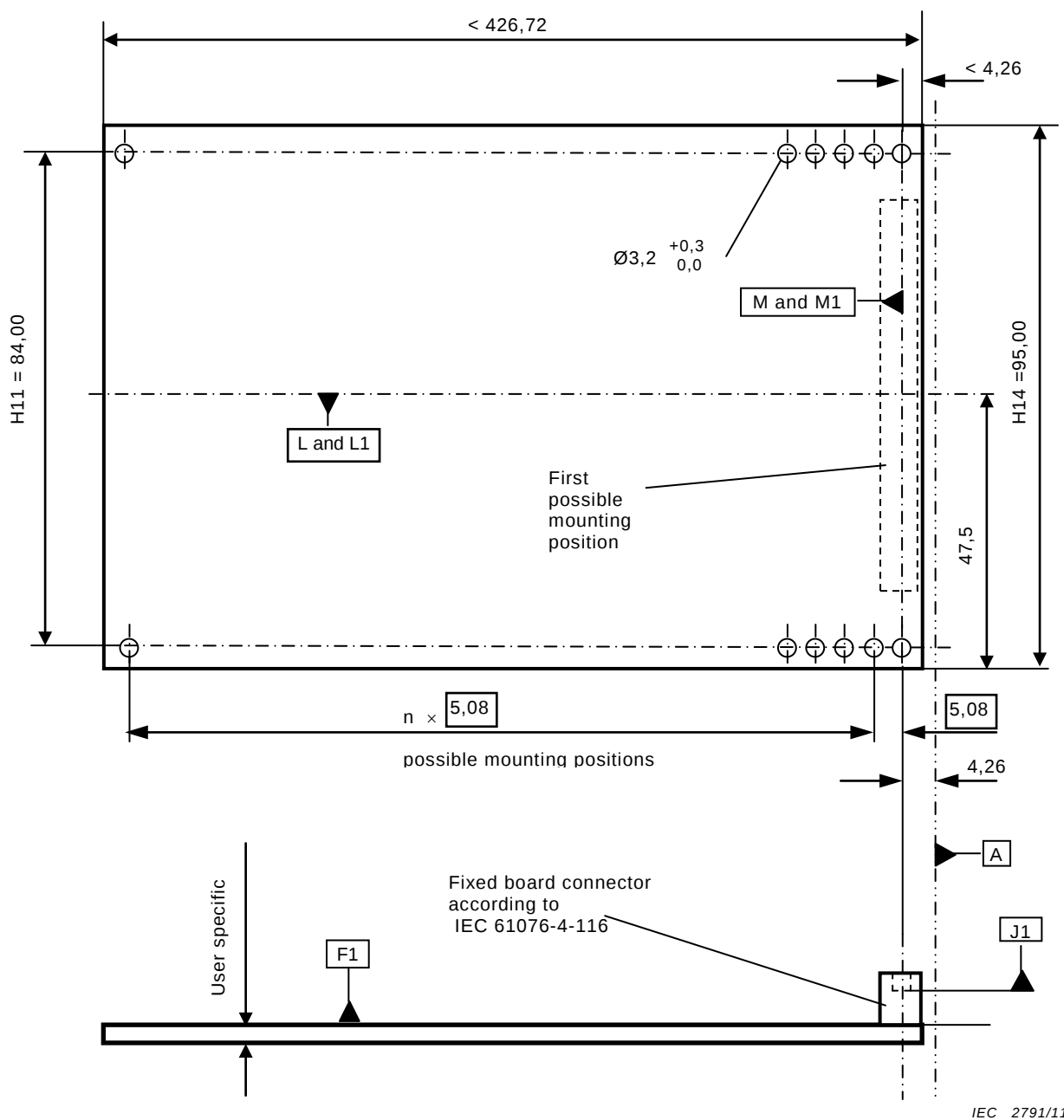


Figure 18a – 3U backplane dimensions, for 2 U plug-in units

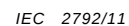


Figure 18 – Backplane dimensions

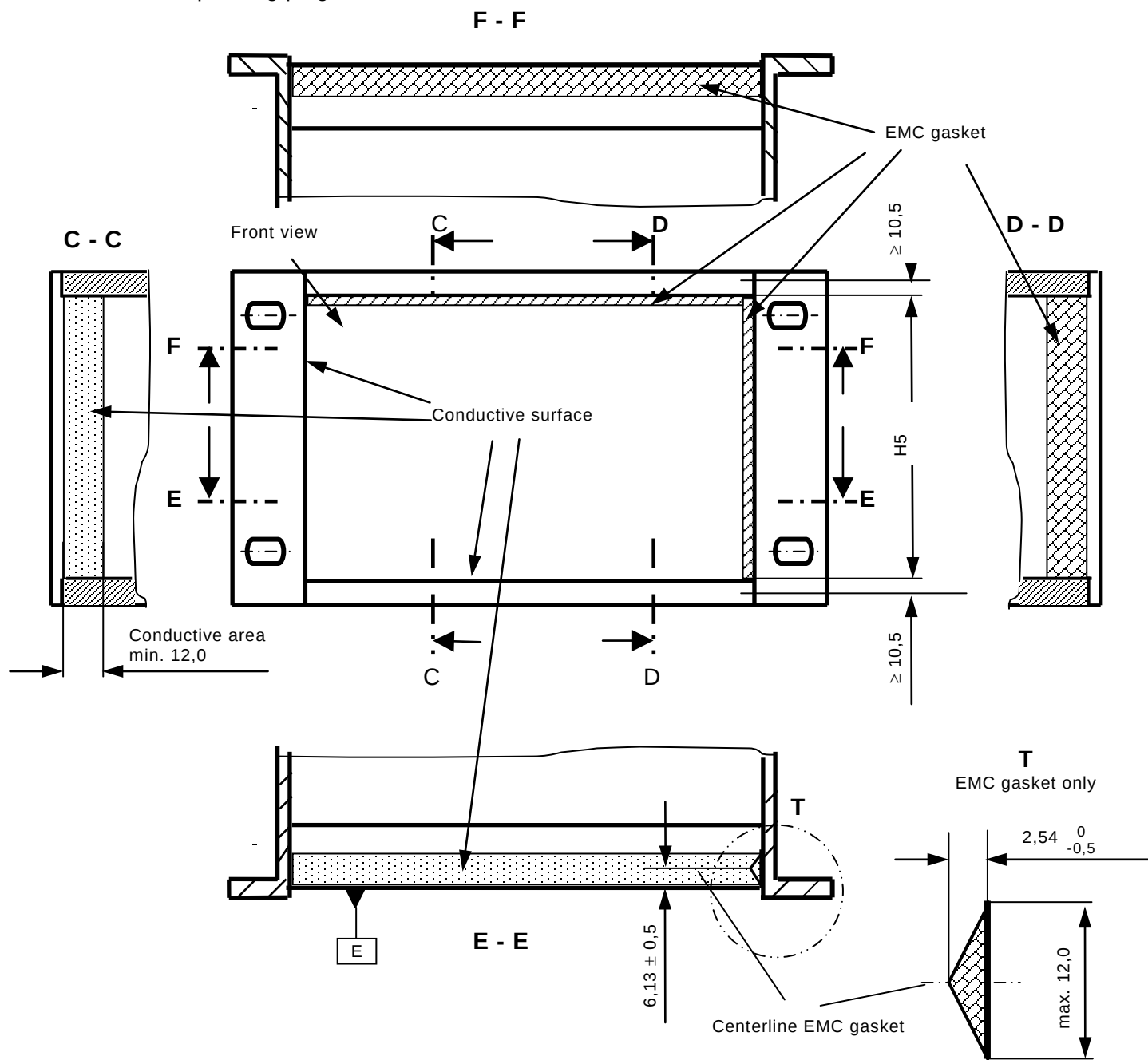
8 Subrack and plug-in units with electromagnetic shielding (EMC) provisions

8.1 General

The dimensional specifications of electromagnetic shielding provisions for subracks and associated plug-in units are restricted to the subrack and plug-in unit interfaces. The basic dimensions are in accordance with Clauses 4 and 5 of this standard. Only the extended dimensions of the shielding interfaces are subject of this clause. Materials of the shielding interfaces should be chosen for adequate contact properties.

8.2 Subrack EMC provisions

For corresponding plug-in unit dimensions, see 5.1.



IEC 2793/11

Figure 19 – Subrack EMC dimensions

8.3 Plug-in unit and filler panels EMC provisions

The basic dimensions are in accordance with Clause 5 of this standard. Only the extended dimensions of the shielding interface are shown.

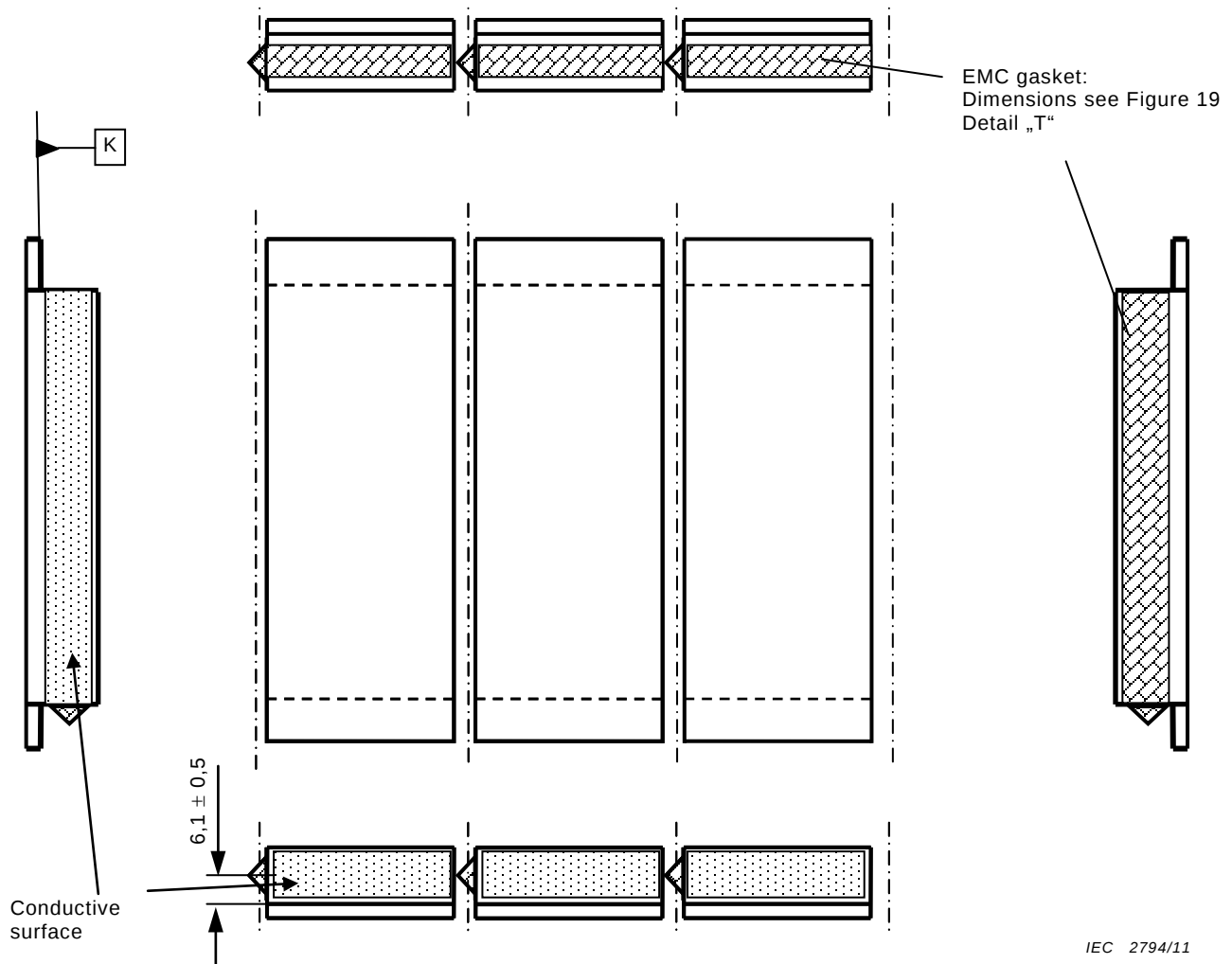


Figure 20 – Plug-in unit EMC dimensions

9 Subrack and plug in units electrostatic discharge provisions (ESD)

9.1 General

This clause specifies the interface dimensions for an electrostatic discharge contact implemented in the guide rail and the corresponding conductive strip on the plug-in unit printed board.

The conductive strips on the printed board are shown for two application requirements: With permanent connection along with the depth dimension of the board or with interruption before the board is fully engaged in the connector.

9.2 Subrack ESD provisions

The ESD contact shall be connected to the subrack horizontal member and spring load fixed within the determined guide rail area. The ESD contact shall be able to connect the inserted board on both sides.

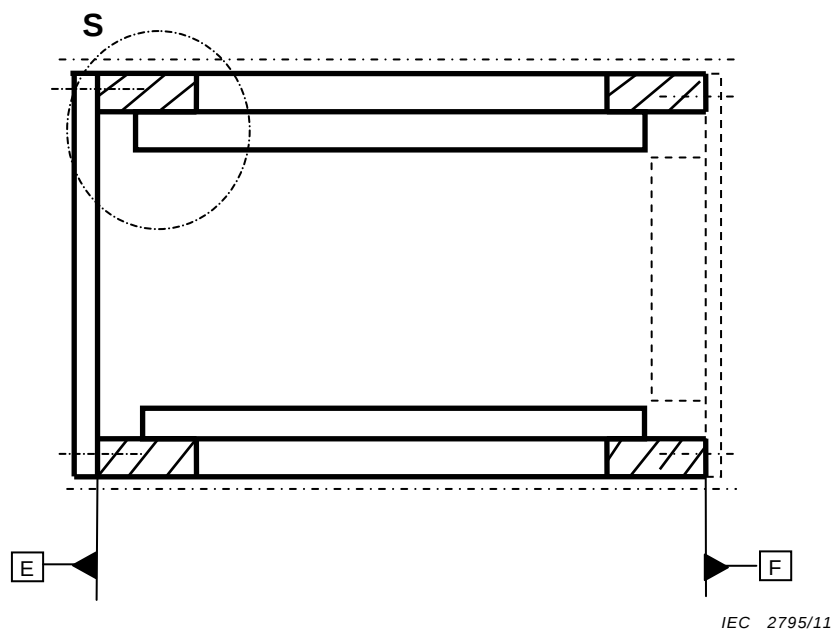


Figure 21a – Subrack ESD provision, overview

Detail S

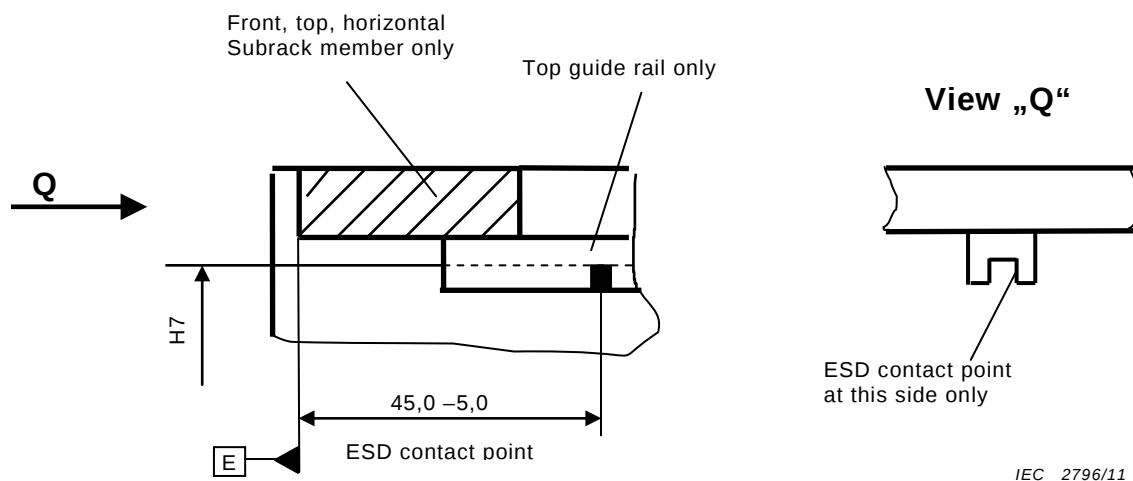
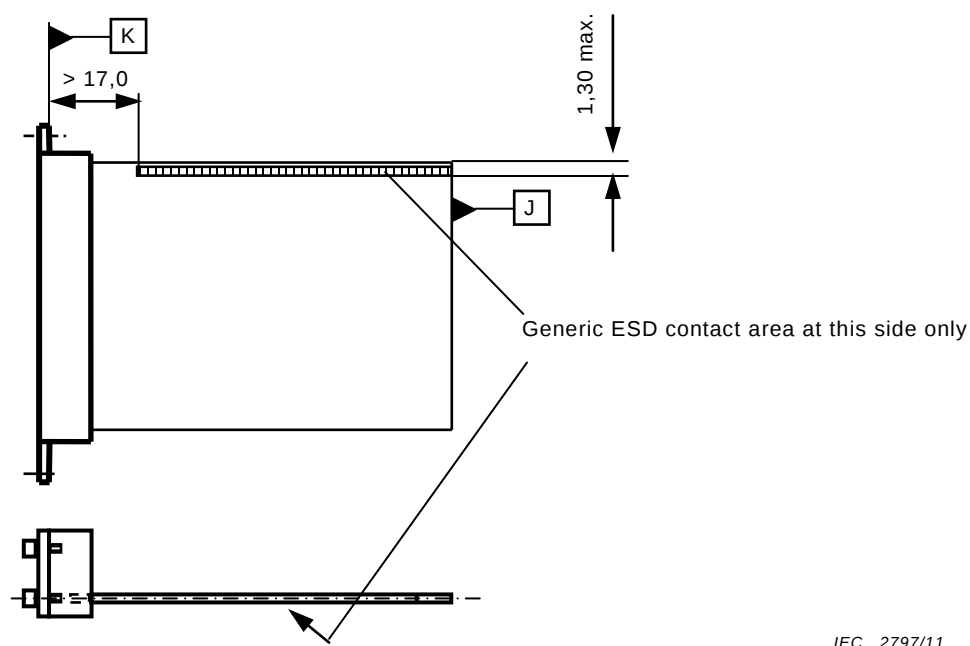


Figure 21b – Subrack ESD provision, guide rail

Figure 21 – Subrack ESD provision

9.3 Plug-in unit ESD provisions, front mounted

Missing dimensions, see Figure 6.



IEC 2797/11

Figure 22 – Plug-in unit ESD provision

Table 1 – Height dimensions

	Height units	
	3 U	4 U
H1 ± 0,4 ^a	132,55	177,00
H2 ± 0,4	57,15	101,60
H3 ± 0,4	37,70	37,70
H4 ± 0,4	-	-
H5 ± 0,4	76,20	151,20
H6 ± 0,2	84,00	159,00
H7 ± 0,4	74,00	149,00
H8 ± 0,2	95,00	170,00
H9 ± 0,2	84,00	159,00
H10 ± 0,1	73,50	148,50
H11 ± 0,2	84,00	159,00
H12 ± 0,2	73,80	148,80
H13 ± 0,1	65,00	65,00
H14 0 / -1,0	95,00	170,00
^a The height dimension H 1 is used as reference if the subrack design is intended to fit into the available height of n × U. Smaller height dimensions may be used as appropriate for stability or special design requirements (H1min = H14).		

Table 2 – Depth dimensions

D 1 ± 0,3	185,85
D 2	162,00
D 3	156,80
D 4 ≤	153,50
D 5 ± 0,4	180,85
D 6 ≤	157,75
RD 1 ± 0,3	185,85

10 Nomenclature

Height

- U: Coordination height unit of 44,45 mm (1,75 in). See IEC 60297-3-100.
- H1: Subrack heights (equal to dimension E of IEC 60297-3-100).
- H2: Subrack to cabinet or rack mounting hole positions (equal to dimensions Y / Z of IEC 60297-3-100).
- H3: Subrack to cabinet or rack mounting hole positions (equal to dimensions A of IEC 60297-3-100).
- H4: Subrack to cabinet or rack mounting hole positions (equal to dimensions Y / Z of IEC 60297-3-100).
- H5: Subrack vertical aperture opening for plug-in units.
- H6: Mounting centre distance for front plug-in units and panels, front and rear.
- H7: Printed board guidance height.
- H8: Plug-in unit panel height.
- H9: Vertical plug-in unit panel mounting centre distance.
- H10: Printed board height into subrack guidance height.
- H11: Mounting centre distance for backplane.
- H12: Front/rear panel body height dimension.
- H13: Printed board height into connector guidance height.
- H14: Backplane height dimension.

Width

- HP: The subrack aperture is theoretically divided into N x horizontal pitches (HP) of 5,08 mm.
- The plug-in unit front panel width is divided into N x 5,08 mm horizontal pitches.

Depth

- D1: Subrack dimension between front attachment plane and backplane attachment plane.
- D2: Dimension between backplane attachment plane and top guide rail unit.
- D3: Dimension between backplane attachment plane and bottom guide rail unit.
- D4: Dimension PB keep out zone – bottom side, utilizing card edge connector.
- D5: Plug-in unit dimension between rear of face plate and utilizing card edge connector.
- D6: Dimension PB keep out zone – top side, utilizing card edge connector.
- RD1: Subrack dimension between rear attachment plane and rear backplane attachment plane.

Reference plane (given in square boxes)

- A: Subrack, first pitch line
- B: Subrack, last pitch line
- C: Subrack, left inside wall
- D: Subrack, right inside wall
- E: Subrack, front attachment plane
- F: Subrack, backplane attachment plane
- F1: Bottom of connector touches F on backplane
- G: Guide rail, interface surface to PB
- G1: Module PB, interface surface to guide rail
- J: Plug-in unit, PB leading edge
- J1: Bottoming position of module PB or free board connector within fixed board connector
- J2: Bottoming position of module PB within free board connector
- J3: Free board connector, leading edge
- K: Plug-in unit, rear of face plate
- L: Centre line module PB and subrack
- L1: Centre line of connector
- M: Centre line of module PB thickness
- M1: Centre line of connector cavity
- M2: Centre line of guide rail
- N: Subrack, rear attachment plane
- O: Subrack, rear backplane attachment plane

Annex A (informative)

Connector hole pattern at the backplane

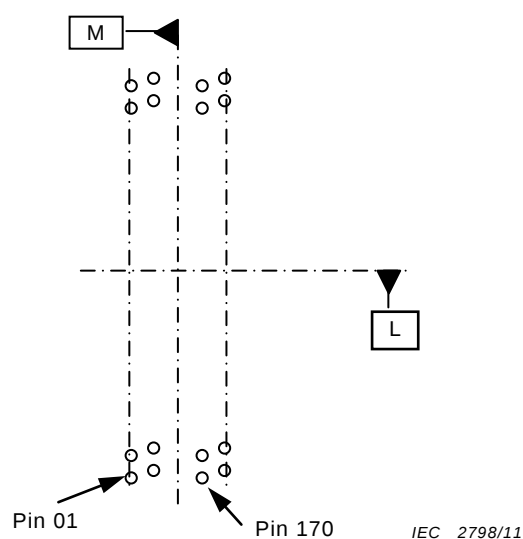


Figure A.1 – Connector pin location according to IEC 61076-4-116, front view

Annex B (informative)

Rear mounted plug-in unit implementation

B.1 Subrack depth dimensions

B.1.1 Subrack type 1

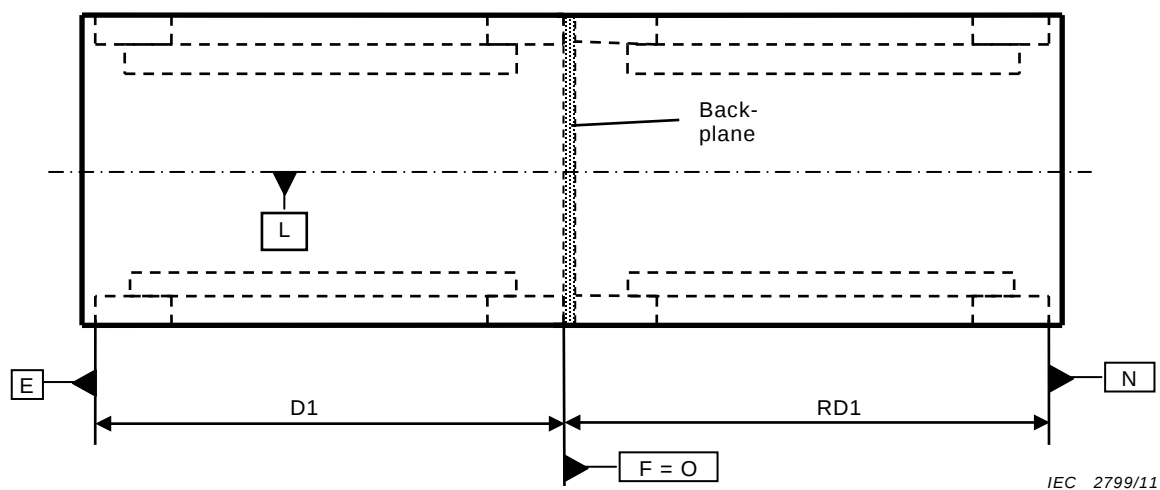


Figure B.1 – Depth dimension subrack type 1, side view

B.1.2 Subrack type 2

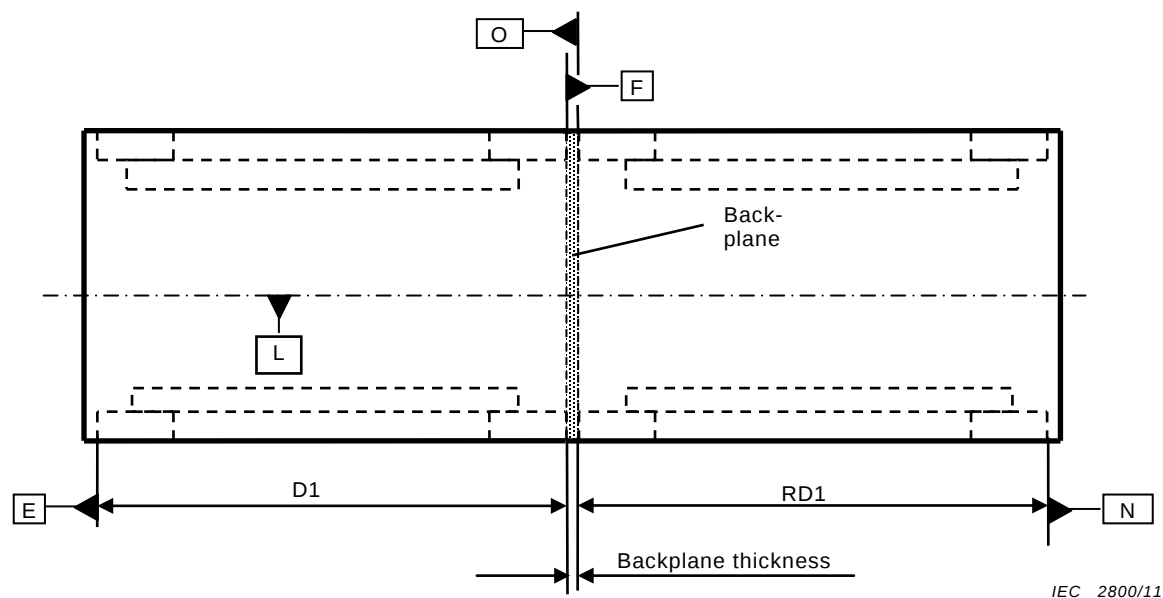
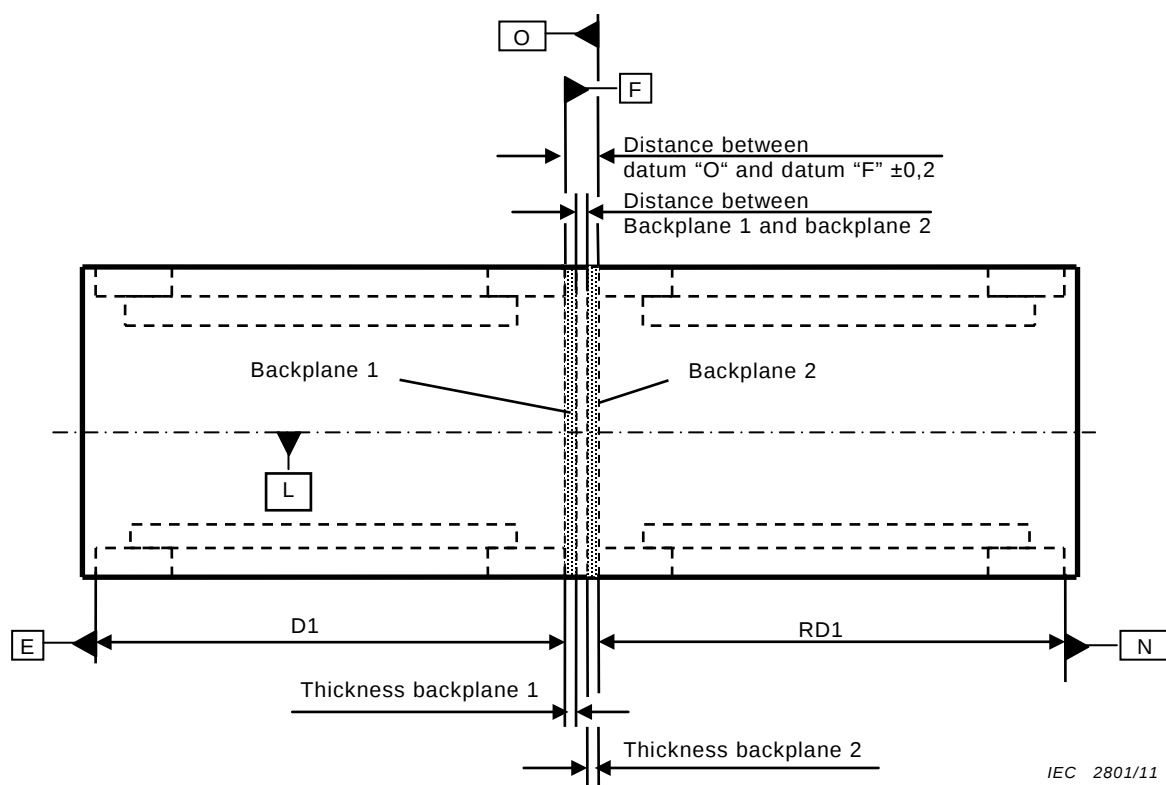


Figure B.2 – Depth dimension subrack type 2, side view

B.1.3 Subrack type 3**Figure B.3 – Depth dimension subrack type 3, side view**

Annex C (informative)

Hot swap latch function

For detailed information, see PICMG-AMC.0 and PICMG-MTCA.0.

Annex D (informative)

Subrack latch mechanism interface dimensions for ruggedized applications

For detailed information, see PICMG-MTCA.1 section 2.5.2.2: Mandatory subrack latch mechanism.

Annex E (informative)

Subrack ESD contact interface dimensions

For detailed information, see PICMG-MTCA.0, Figure 2-42; view Y.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	38
INTRODUCTION.....	40
1 Domaine d'application et objet.....	41
2 Références normatives.....	41
3 Vue d'ensemble de disposition (4U représentés)	42
4 Dimensions des bacs.....	43
4.1 Dimensions des bacs, zone de montage avant	43
4.2 Dimensions des bacs, vue de derrière, zone de montage des fonds de panier.....	46
5 Dimensions des blocs enfichables	47
6 Connecteur et dimensions de carte imprimée associée.....	48
6.1 Connecteur conforme à la spécification PICMG-MicroTCA.0/CEI 61076-4-116, connecteur pour carte fixe et dimensions de carte imprimée associée	48
6.1.1 Connecteur PICMG- MicroTCA.0/CEI 61076-4-116, vue isométrique	48
6.1.2 Connecteur conforme à la spécification PICMG-MicroTCA.0/CEI 61076-4-116, connecteur pour carte fixe et carte imprimée associée – vue d'ensemble de disposition	48
6.1.3 Dimensions de carte imprimée.....	49
6.1.4 Dimensions de carte imprimée, exemple 4U	50
6.1.5 Connecteur conforme à la spécification PICMG-MTCA.0, dimensions de connecteur pour carte fixe	51
6.2 Connecteur en deux parties conforme à la CEI 61076-4-116 et dimensions de carte imprimée associée.....	52
6.2.1 Connecteur en deux parties, vue isométrique	52
6.2.2 Connecteur en deux parties, vue d'ensemble de disposition	53
6.2.3 Connecteur en deux parties, dimensions de carte imprimée	53
6.2.4 Connecteur en deux parties, dimensions de connecteur pour carte fixe	54
6.3 Connecteur en deux parties avec fixations latérales pour composant sur carte imprimée PIU.....	54
6.3.1 Connecteur en deux parties, vue d'ensemble de disposition	54
6.3.2 Connecteur en deux parties, dimensions de carte imprimée, 2 U	54
6.3.3 Connecteur en deux parties, connecteur installé dans un fond de panier, 2 U	55
7 Dimensions des fonds de panier	56
7.1 Dimensions des fonds de panier utilisant des connecteurs en deux parties conformément à la CEI 61076-4-116	56
8 Bacs et blocs enfichables avec dispositions pour blindage électromagnétique (CEM).....	58
8.1 Généralités.....	58
8.2 Dispositions CEM des bacs	58
8.3 Dispositions CEM des panneaux de remplissage et des blocs enfichables	59
9 Dispositions pour décharges électrostatiques (ESD) pour bacs et blocs enfichables.....	59
9.1 Généralités.....	59
9.2 Dispositions ESD des bacs.....	60
9.3 Dispositions ESD des blocs enfichables, montage avant	61
10 Nomenclature	62
Annexe A (informative) Diagramme des trous de connecteurs sur le fond de panier.....	64
Annexe B (informative) Mise en œuvre de blocs enfichables à montage arrière	65

Annexe C (informative) Fonction de remplacement à chaud	67
Annexe D (informative) Dimensions d'interface de mécanisme de verrouillage des bacs pour exigences renforcées.....	68
Annexe E (informative) Dimension d'interface de contact ESD des bacs	69
Figure 1 – Vue d'ensemble de disposition	42
Figure 2 – Dimensions des bacs, vue de devant	44
Figure 3 – Dimensions des bacs, vue latérale	45
Figure 4 – Dimensions des bacs, vue de dessus	46
Figure 5 – Dimensions des bacs, vue de derrière.....	46
Figure 6 – Dimensions des blocs enfichables.....	47
Figure 7 – Connecteur PICMG- MicroTCA.0/ CEI 61076-4-116, vue isométrique.....	48
Figure 8 – Connecteur pour carte fixe PICMG- MicroTCA.0/ CEI 61076-4-116, vue d'ensemble de la disposition – vue de dessus.....	48
Figure 9 – Dimensions de carte imprimée	49
Figure 10 – Dimensions de carte imprimée, exemple 4U	50
Figure 11 – Connecteur conforme à la spécification PICMG-MTCA.0, dimensions de connecteur pour carte fixe	51
Figure 12 – Connecteur pour carte fixe et pour carte libre – Vue isométrique.....	52
Figure 13 – Connecteur en deux parties, vue d'ensemble de disposition – Vue de dessus.....	53
Figure 14 – Connecteur en deux parties, dimensions de carte imprimée	53
Figure 15 – Connecteur en deux parties, vue d'ensemble de disposition – Vue de dessus	54
Figure 16 – Connecteur en deux parties, dimensions, 2 U.....	54
Figure 17 – Connecteur en deux parties, dimensions de connecteur installé dans un fond de panier, 2 U	55
Figure 18 – Dimensions des fonds de panier.....	57
Figure 19 – Dimensions CEM des bacs.....	58
Figure 20 – Dimensions CEM des blocs enfichables	59
Figure 21 – Dispositions ESD des bacs	60
Figure 22 – Dispositions ESD des blocs enfichables	61
Figure A.1 – Emplacement des broches de connecteur selon la CEI 61076-4-116, vue avant	64
Figure B.1 – Dimensions en profondeur d'un bac de type 1, vue latérale.....	65
Figure B.2 – Dimensions en profondeur d'un bac de type 2, vue latérale.....	65
Figure B.3 – Dimensions en profondeur d'un bac de type 3, vue latérale.....	66
Tableau 1 – Dimensions en hauteur	61
Tableau 2 – Dimensions en profondeur	62

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

STRUCTURES MÉCANIQUES POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES – DIMENSIONS DES STRUCTURES MÉCANIQUES DE LA SÉRIE 482,6 mm (19 pouces) –

Partie 3-107: Dimensions des bacs et blocs enfichables de petit facteur de forme

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60297-3-107 a été établie par le sous-comité 48D: Structures mécaniques pour équipement électronique, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de la présente Norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
48D/492/FDIS	48D/501/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de la présente Norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60297, présentées sous le titre général *Structures mécaniques pour équipements électroniques – Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces)*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

INTRODUCTION

La présente Norme présente un facteur de forme pour blocs enfichables, plus petit ou différent de ceux définis dans la CEI 60297-3-101.

Les nouvelles technologies qui font appel à des blocs enfichables de facteur de forme plus petit utilisés dans des équipements de 19 pouces sont rapidement acceptées par les marchés.

Ce développement reconnu, il devient évident qu'une Norme d'interface générique constituerait un avantage pour l'industrie.

La présente Norme est basée sur et coordonnée avec le facteur de forme pour blocs enfichables tel qu'il est défini par les spécifications AMC.0 et MicroTCA développées par PICMG (PCI Industrial Computers Manufacturer Group).

En rendant les dimensions d'interface critiques accessibles et en permettant l'utilisation de connecteurs alternatifs par l'industrie (au-delà des formats AMC.0 et MicroTCA), de nombreuses solutions produits peuvent utiliser cette technologie pour augmenter l'acceptation globale par le marché, augmenter la disponibilité et réduire les coûts.

Pour satisfaire aux exigences des blocs enfichables de petit facteur de forme placés à l'intérieur d'un bac, les dimensions requises pour l'interface diffèrent de celles indiquées dans la CEI 60297-3-101. La présente Norme définit ces dimensions d'interface de petit facteur de forme.

Les dimensions génériques de petit facteur de forme sont basées sur et coordonnées avec les spécifications AMC.0 et MicroTCA.

Puisque les spécifications AMC.0 et MicroTCA définissent uniquement une gamme limitée de connecteurs, la présente Norme permet l'utilisation d'autres connecteurs appropriés.

STRUCTURES MÉCANIQUES POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES – DIMENSIONS DES STRUCTURES MÉCANIQUES DE LA SÉRIE 482,6 mm (19 pouces) –

Partie 3-107: Dimensions des bacs et blocs enfichables de petit facteur de forme

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 60297 définit les dimensions d'interface entre des bacs et des blocs enfichables associés à l'aide de connecteurs comme cela est défini dans la spécification PICMG-MTCA.0 (cartes fixes, voir Figure 7) et dans la CEI 61076-4-116 (en deux parties, voir Figure 12) et d'autres connecteurs en deux parties (voir Figure 15).

Pour les essais mécaniques et climatiques, se rapporter à la CEI 61587-1.

Pour les essais de performances du blindage électromagnétique, se reporter à la CEI 61587-3.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60297-3-100: *Structures mécaniques pour équipements électroniques – Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces) – Partie 3-100: Dimensions de base des panneaux avant, des bacs, des châssis, des bâtis et des baies*

IEC 61076-4-116: *Connectors for electronic equipment – Product requirements – Printed board connectors: Detail specification for a high-speed two-part connector with integrated shielding function* (à publier – disponible en anglais seulement)

PICMG AMC.0: *Advanced Mezzanine Card Specification* (disponible en anglais seulement)

PICMG MicroTCA.0: *Micro Telecommunications Computing Architecture* (disponible en anglais seulement)

PICMG MicroTCA.1: *Air Cooled Rugged MicroTCA Specification* (disponible en anglais seulement)

3 Vue d'ensemble de disposition (4U représentés)

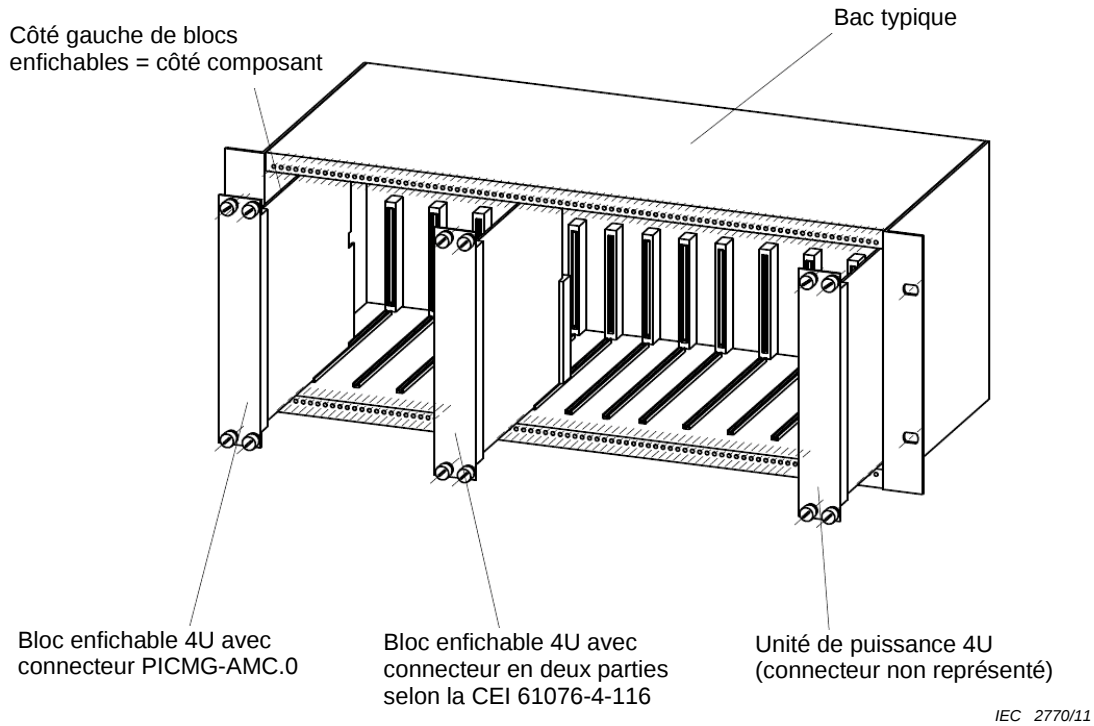


Figure 1 – Vue d'ensemble de disposition

4 Dimensions des bacs

4.1 Dimensions des bacs, zone de montage avant

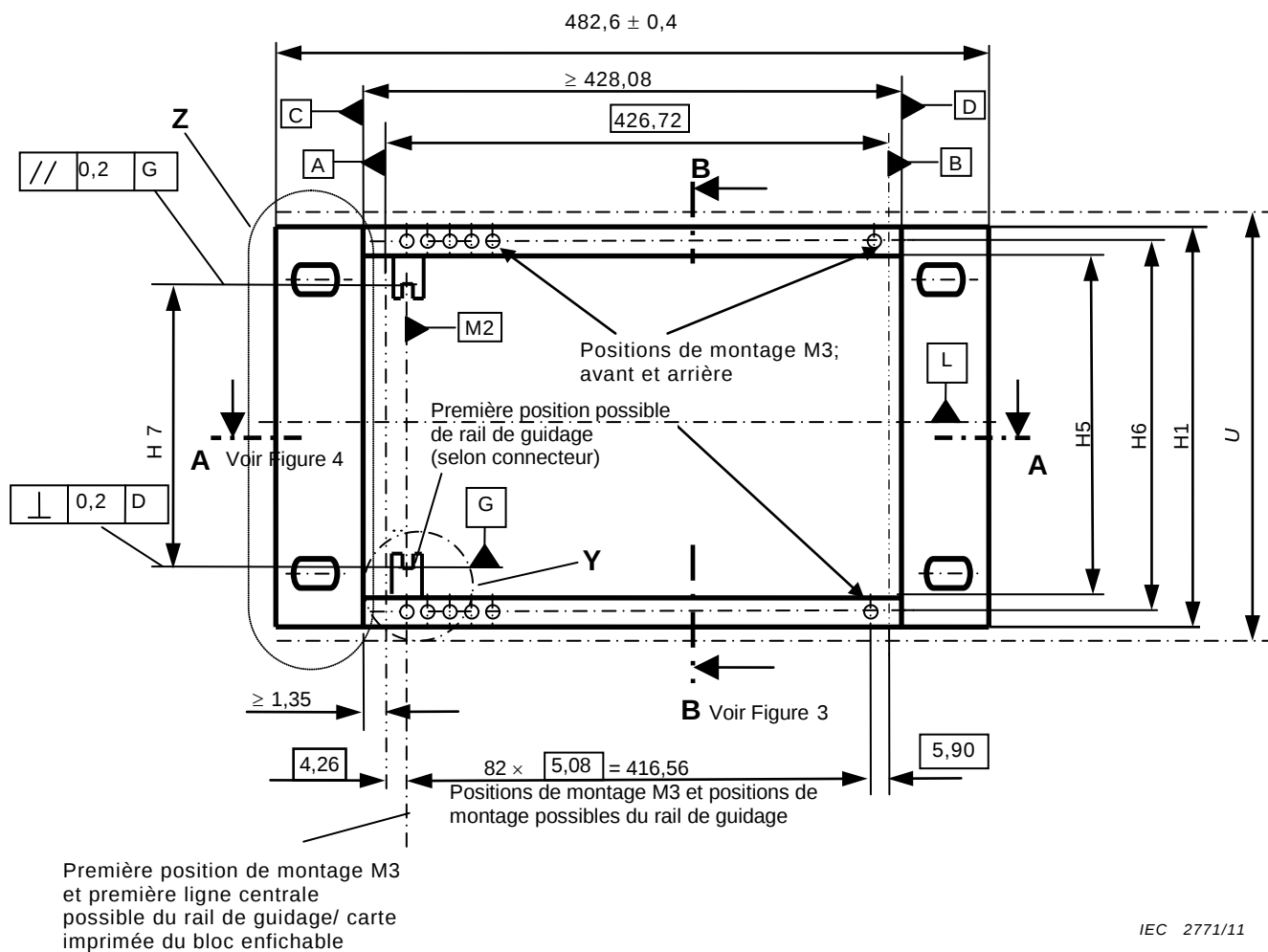


Figure 2a – Dimensions de devant

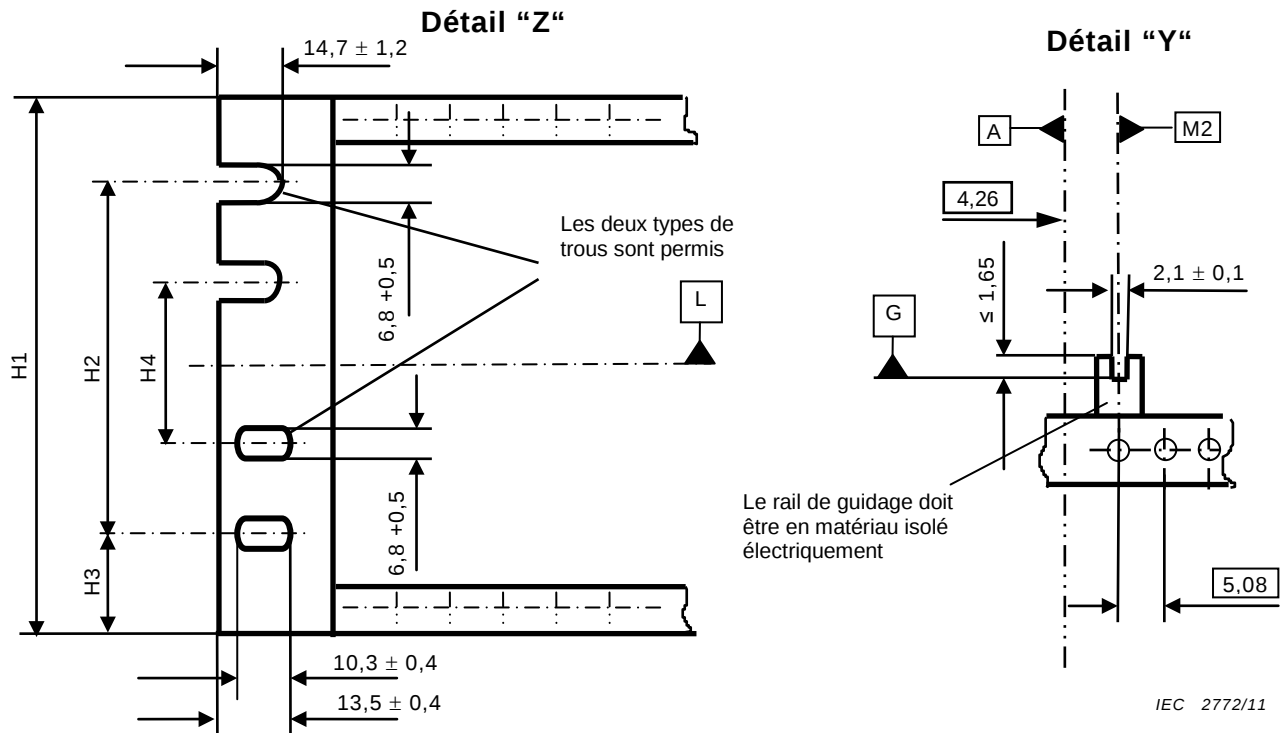


Figure 2b – Trous de montage et dimensions des rails de guidage

Figure 2 – Dimensions des bacs, vue de devant

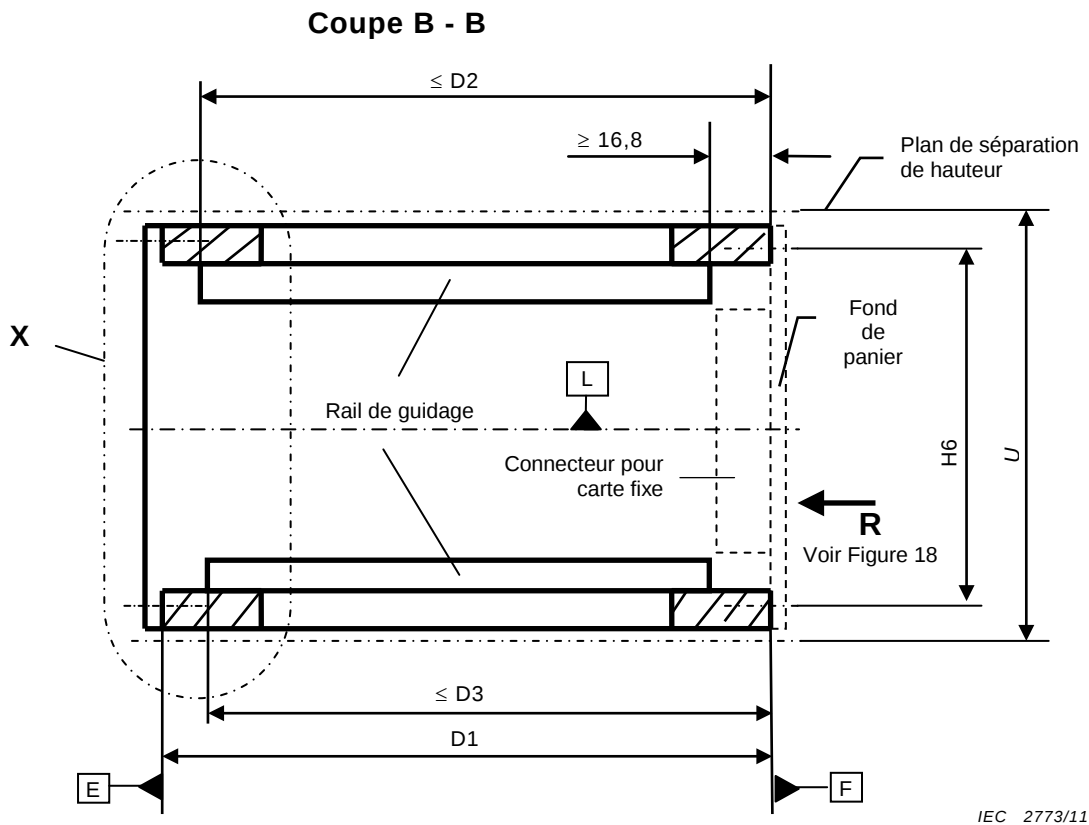


Figure 3a – Dimensions des rails de guidage

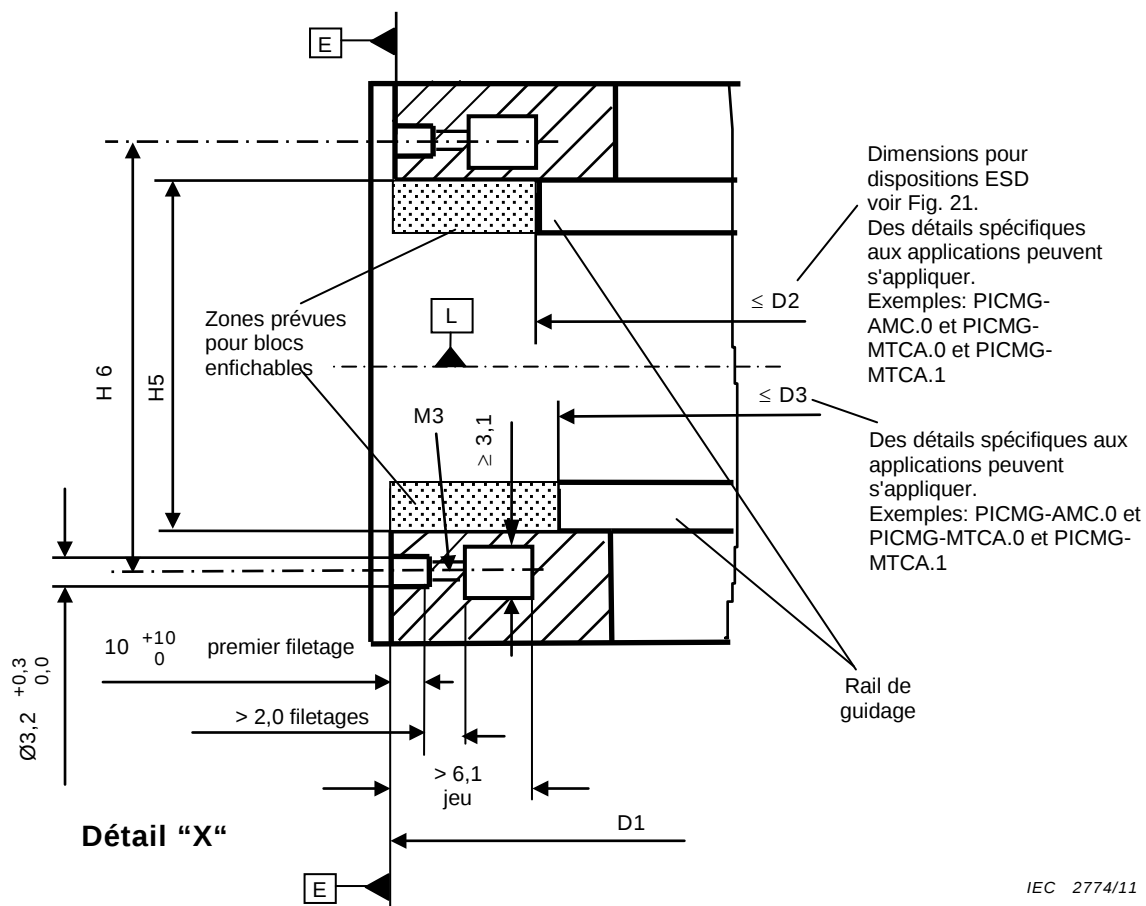


Figure 3b – Dimensions des trous de montage

Figure 3 – Dimensions des bacs, vue latérale

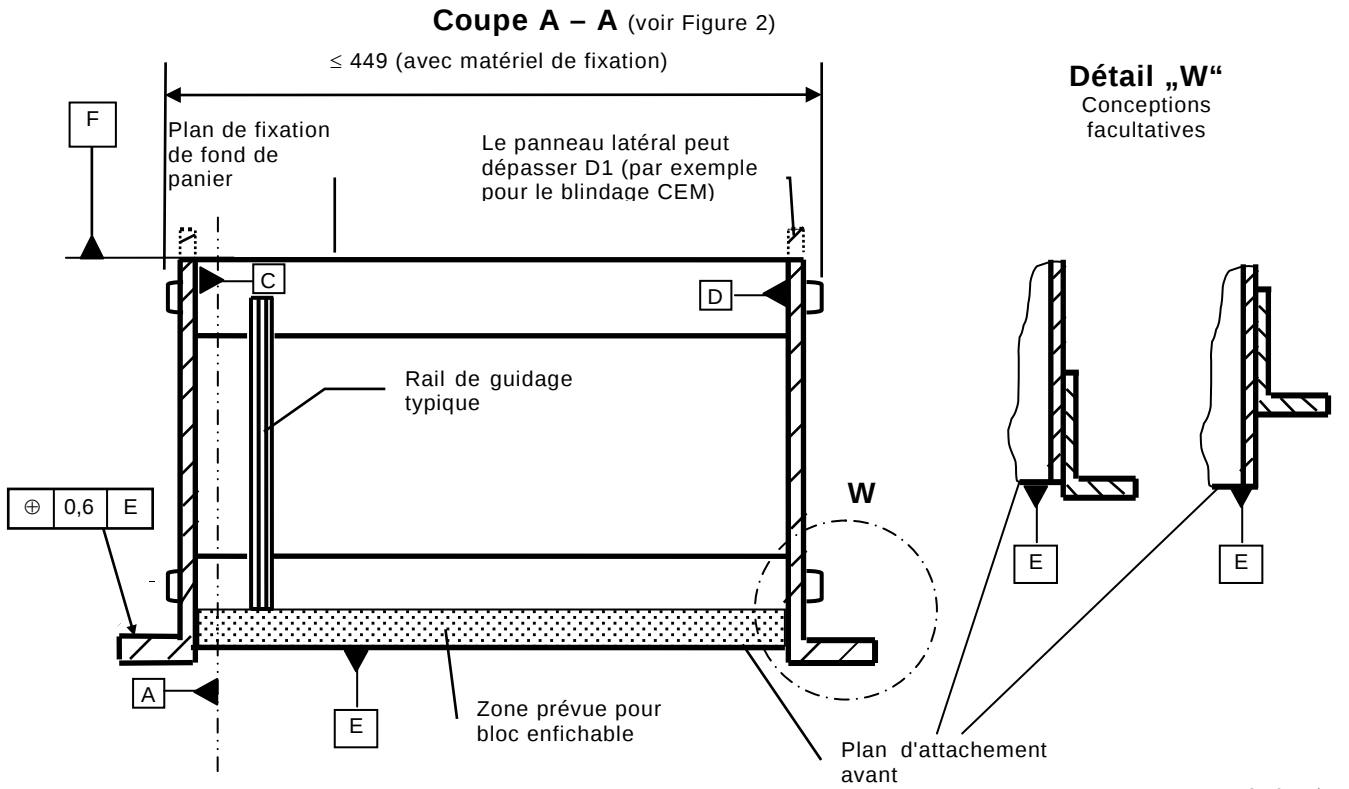


Figure 4 – Dimensions des bacs, vue de dessus

4.2 Dimensions des bacs, vue de derrière, zone de montage des fonds de panier

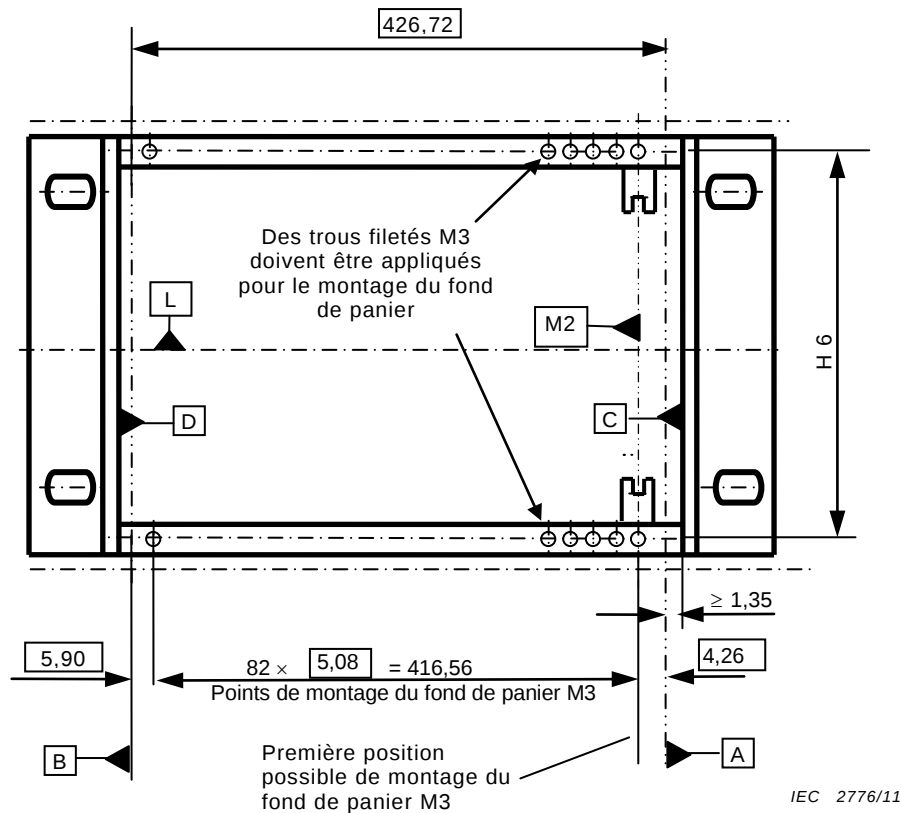


Figure 5 – Dimensions des bacs, vue de derrière

5 Dimensions des blocs enfichables

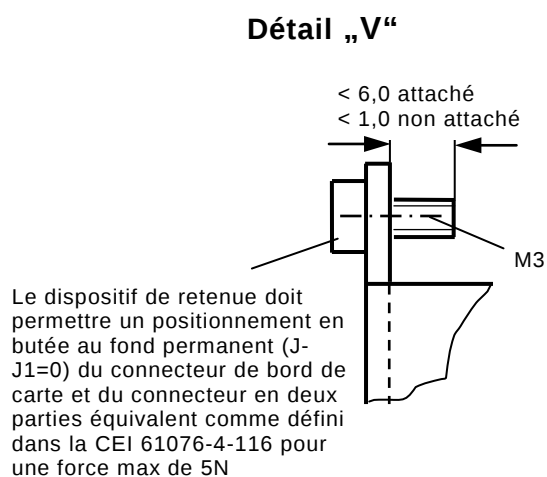
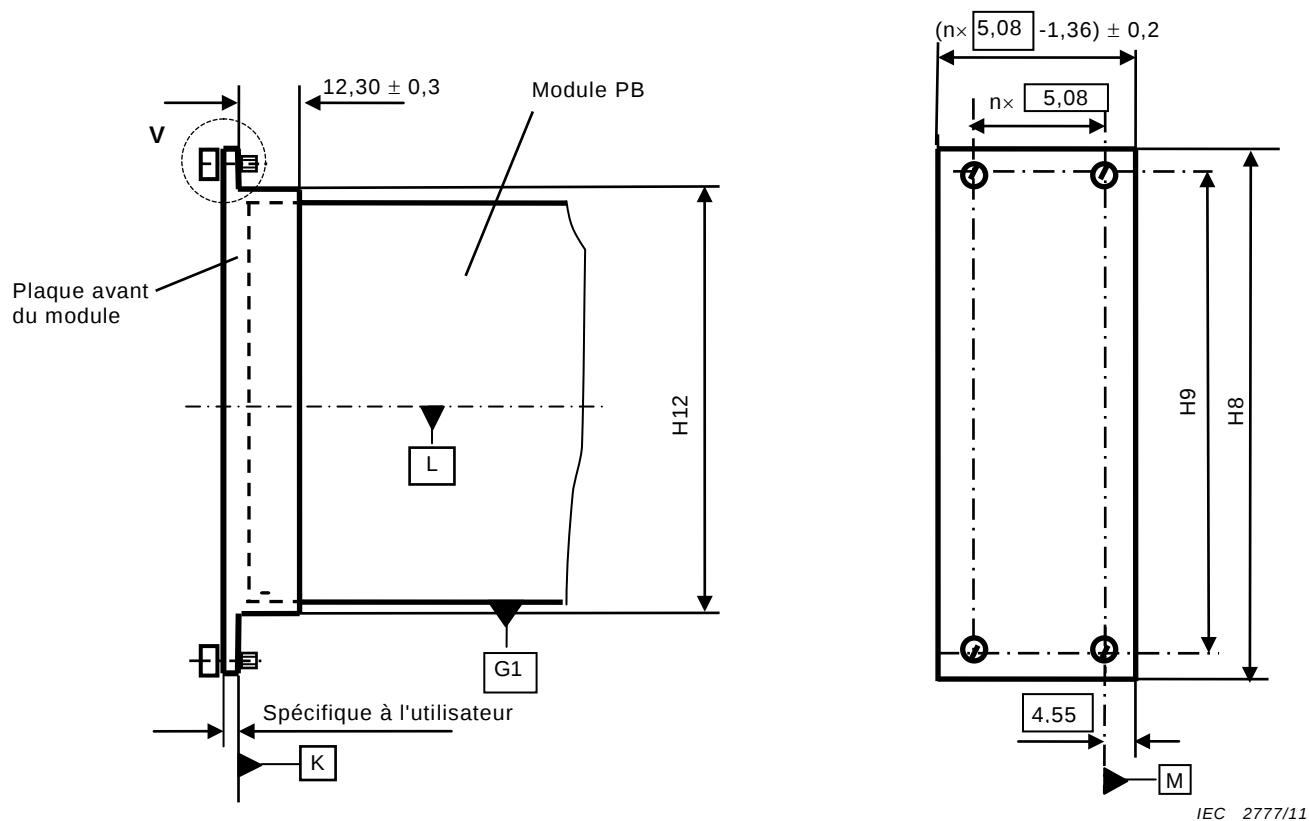


Figure 6b – Dimensions du dispositif de retenue

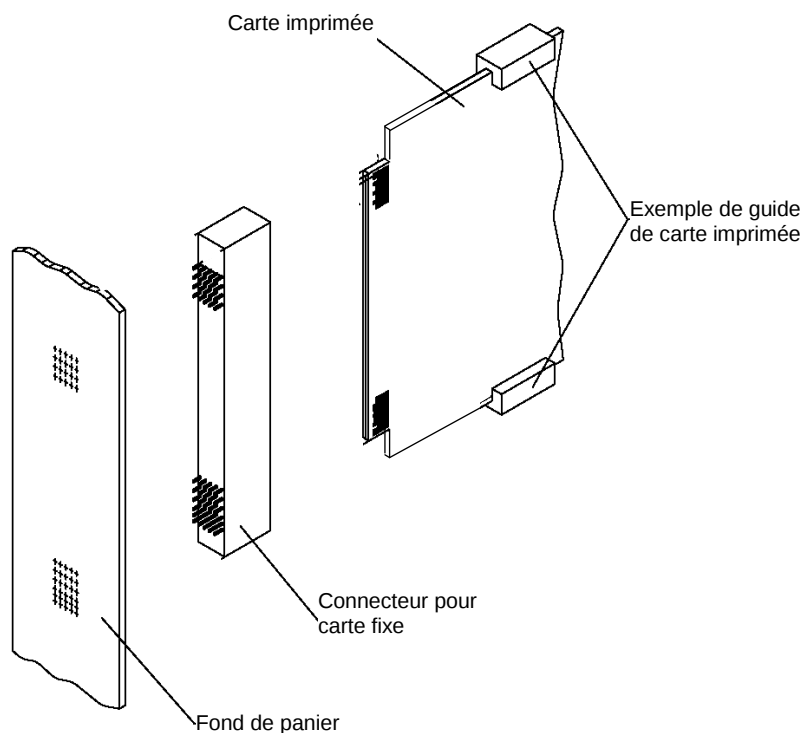
Figure 6 – Dimensions des blocs enfichables

6 Connecteur et dimensions de carte imprimée associée

NOTE Le connecteur pour carte fixe conforme à MTCA.0 est identique au connecteur pour carte fixe de la CEI 61076-4-116.

6.1 Connecteur conforme à la spécification PICMG-MicroTCA.0/CEI 61076-4-116, connecteur pour carte fixe et dimensions de carte imprimée associée

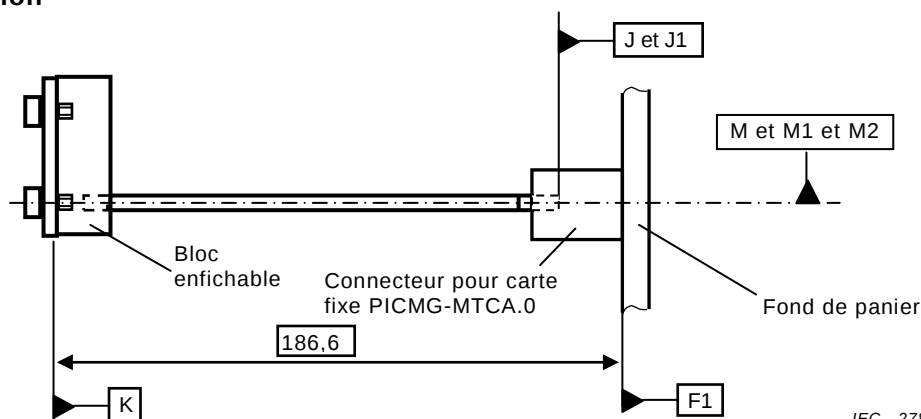
6.1.1 Connecteur PICMG- MicroTCA.0/CEI 61076-4-116, vue isométrique



IEC 2779/11

Figure 7 – Connecteur PICMG- MicroTCA.0/ CEI 61076-4-116, vue isométrique

6.1.2 Connecteur conforme à la spécification PICMG-MicroTCA.0/ CEI 61076-4-116, connecteur pour carte fixe et carte imprimée associée – vue d'ensemble de disposition



IEC 2780/11

Figure 8 – Connecteur pour carte fixe PICMG- MicroTCA.0/ CEI 61076-4-116, vue d'ensemble de la disposition – vue de dessus

6.1.3 Dimensions de carte imprimée

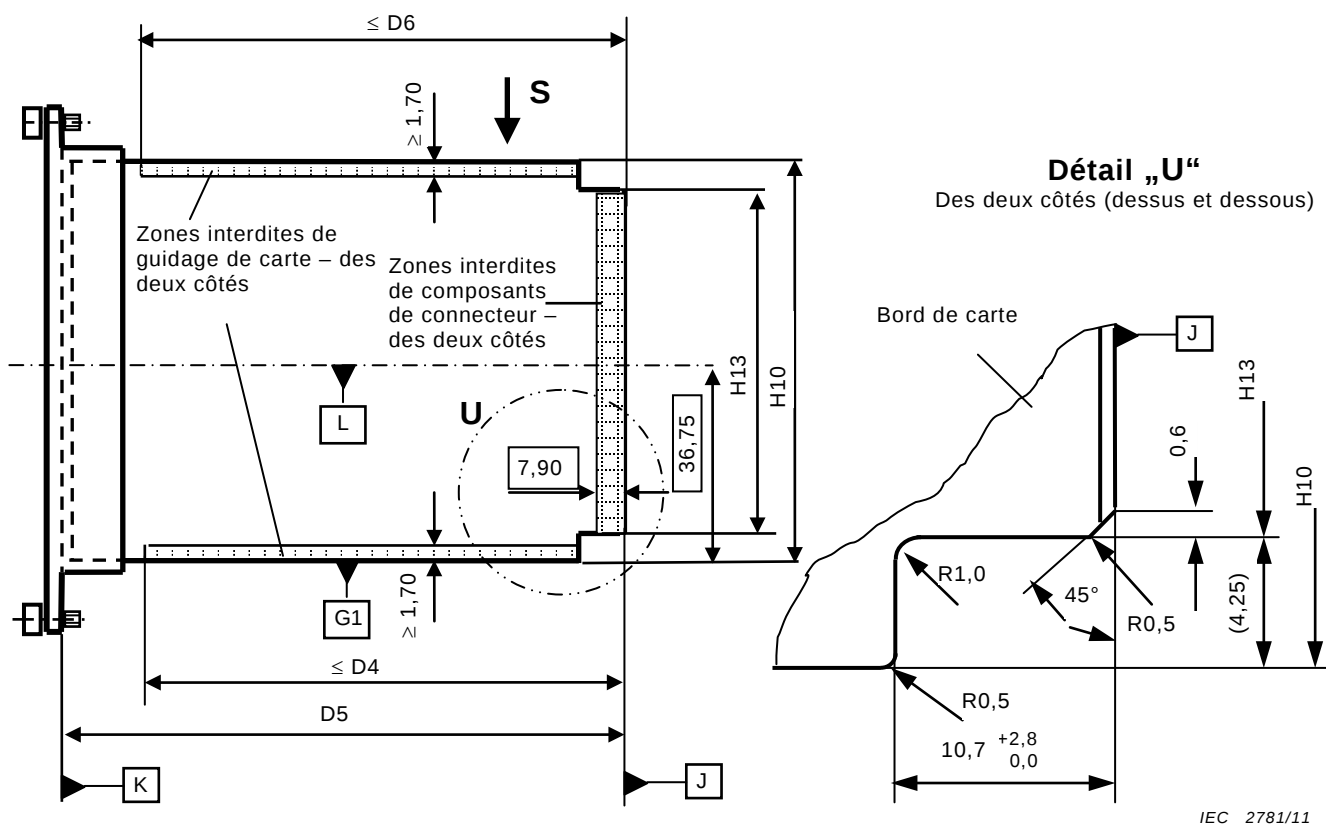


Figure 9a – Dimensions de carte imprimée, vue latérale

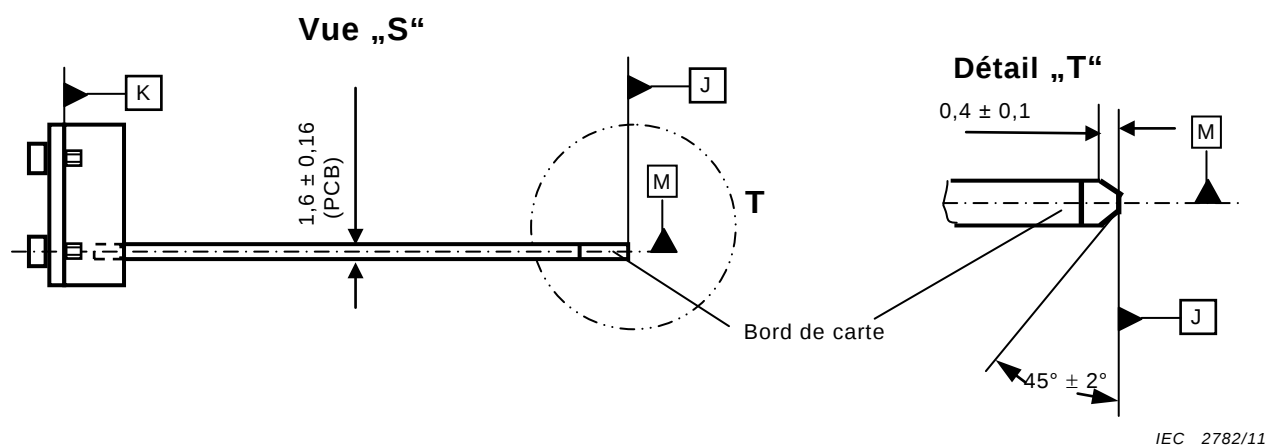


Figure 9b – Dimensions de carte imprimée, vue de dessus

Figure 9 – Dimensions de carte imprimée

6.1.4 Dimensions de carte imprimée, exemple 4U

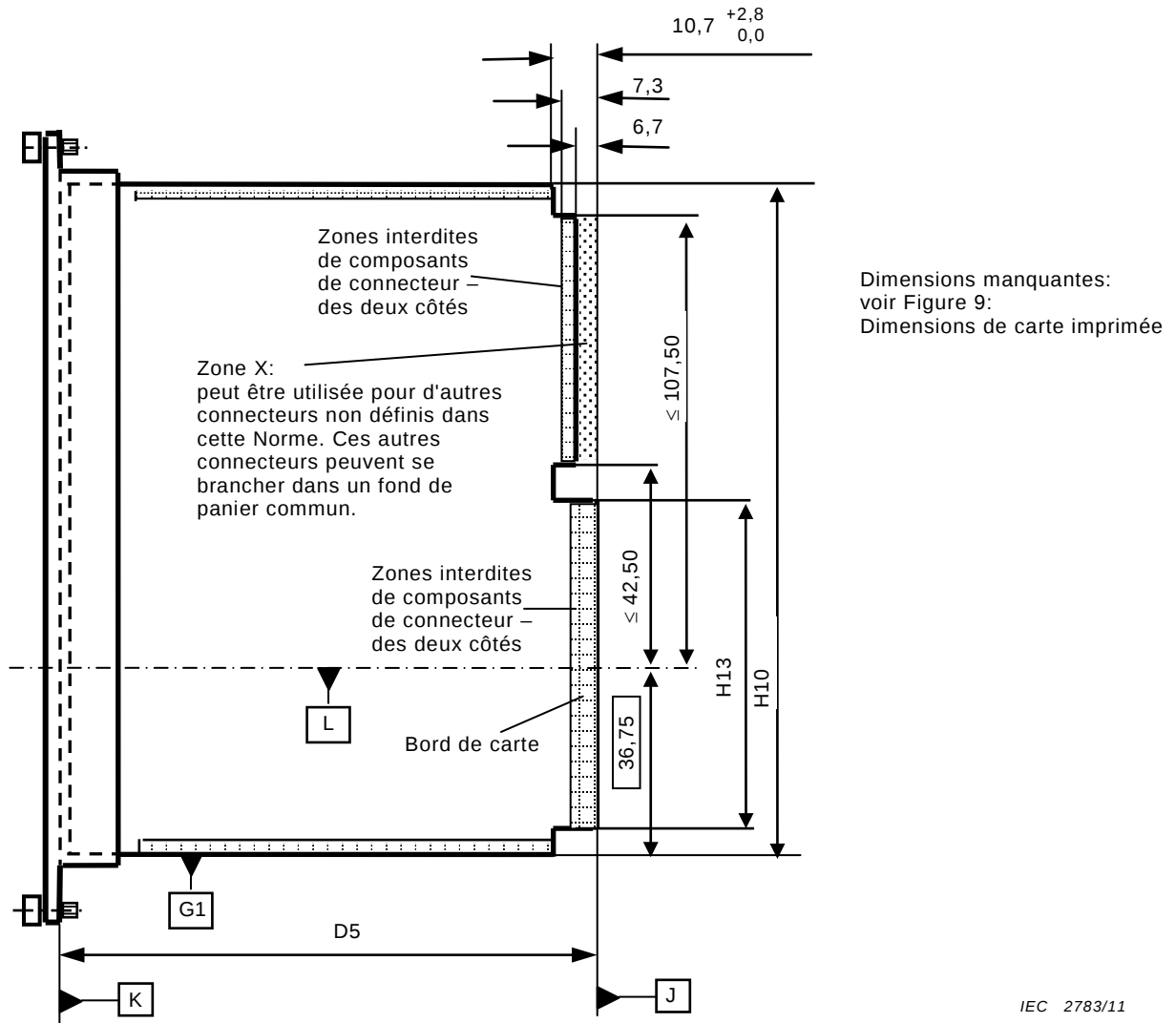


Figure 10 – Dimensions de carte imprimée, exemple 4U

6.1.5 Connecteur conforme à la spécification PICMG-MTCA.0, dimensions de connecteur pour carte fixe

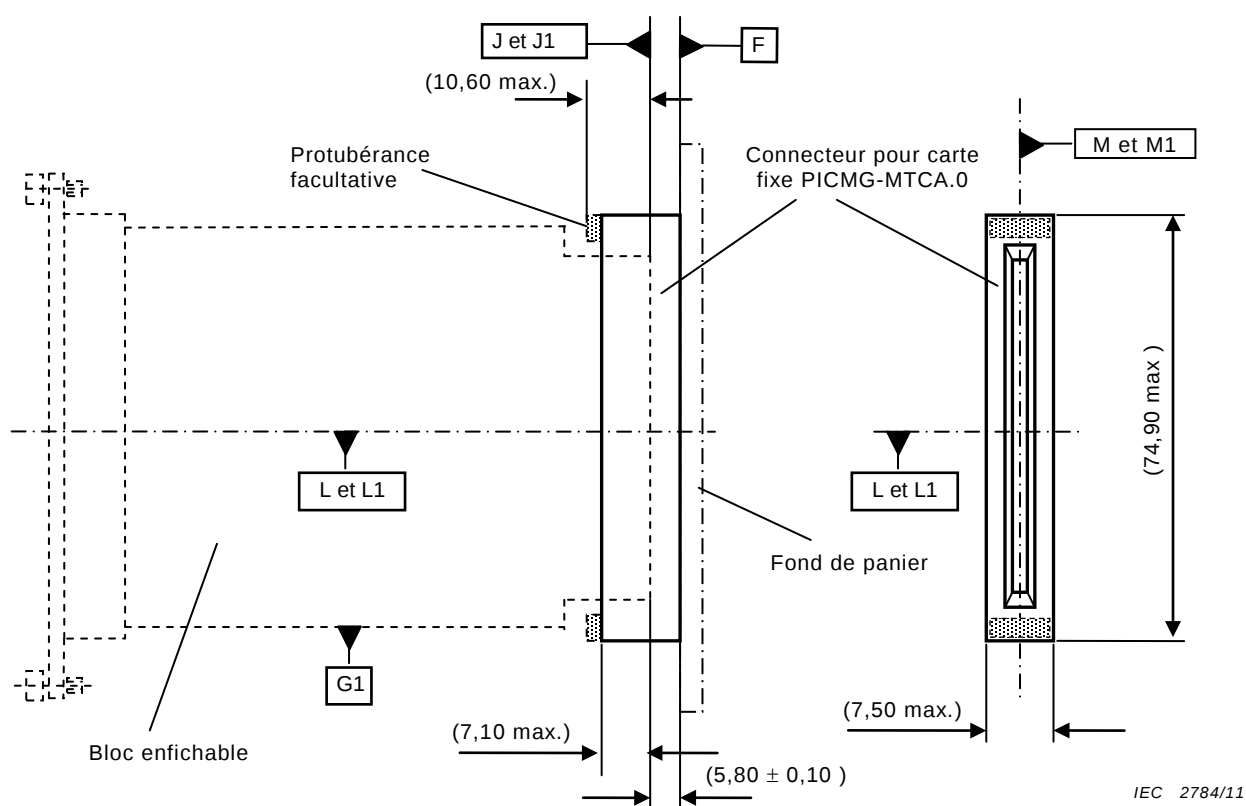
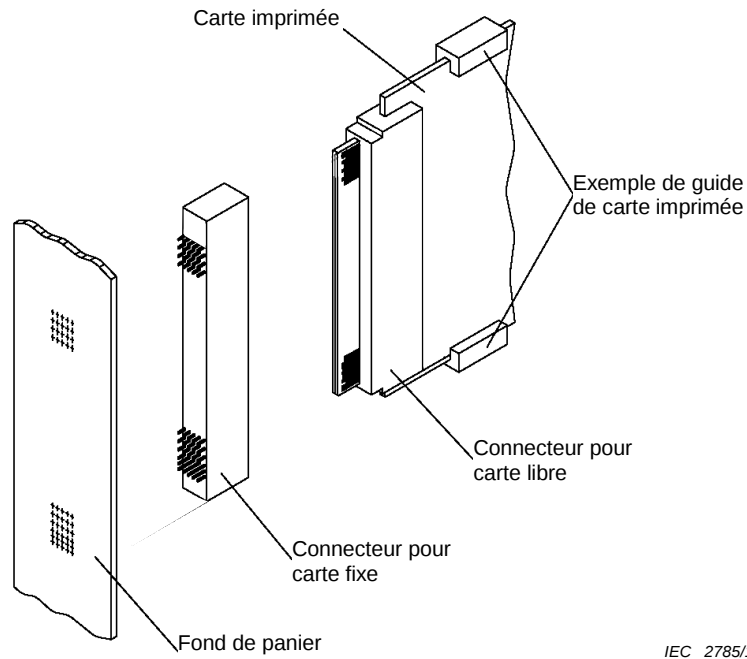


Figure 11 – Connecteur conforme à la spécification PICMG-MTCA.0, dimensions de connecteur pour carte fixe

6.2 Connecteur en deux parties conforme à la CEI 61076-4-116 et dimensions de carte imprimée associée

6.2.1 Connecteur en deux parties, vue isométrique



IEC 2785/11

Figure 12 – Connecteur pour carte fixe et pour carte libre – Vue isométrique

6.2.2 Connecteur en deux parties, vue d'ensemble de disposition

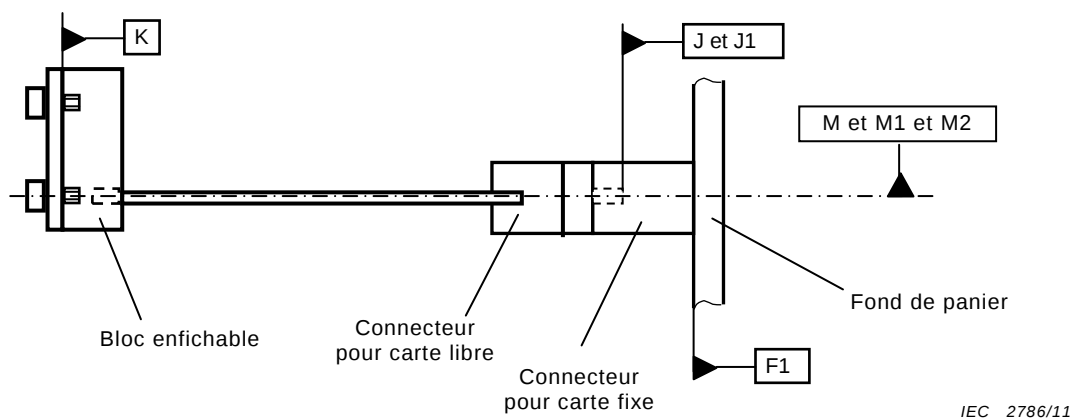


Figure 13 – Connecteur en deux parties, vue d'ensemble de disposition – Vue de dessus

6.2.3 Connecteur en deux parties, dimensions de carte imprimée

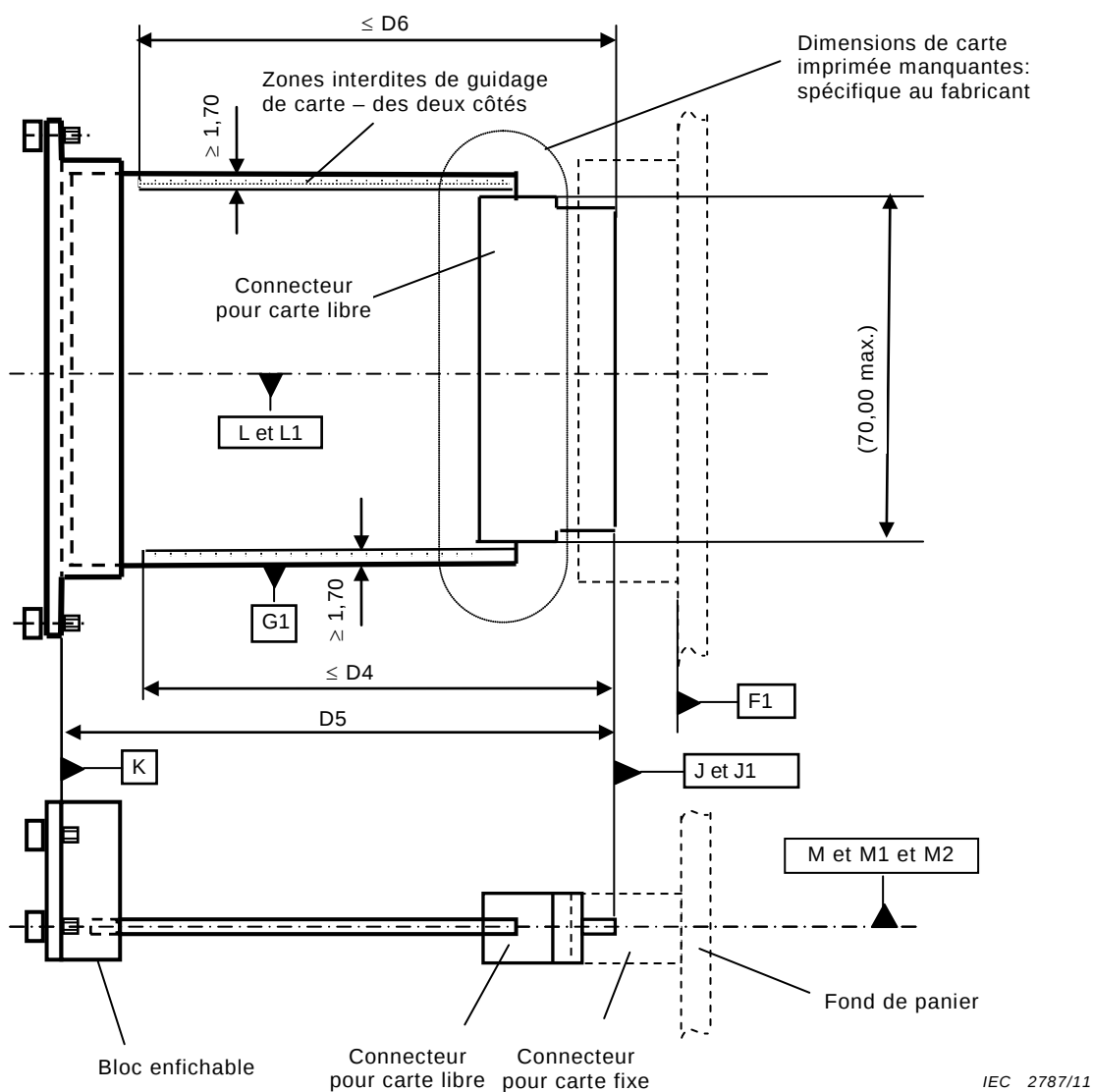


Figure 14 – Connecteur en deux parties, dimensions de carte imprimée

6.2.4 Connecteur en deux parties, dimensions de connecteur pour carte fixe

Voir 6.1.5: Dimensions de connecteur pour carte fixe

6.3 Connecteur en deux parties avec fixations latérales pour composant sur carte imprimée PIU

NOTE Les connecteurs typiquement montés sur une carte imprimée PIU sur une des surfaces des composants externes sont basés sur une épaisseur nominale de carte imprimée de 1,6 mm dans le cadre de la présente Norme. Voir Figure 15.

6.3.1 Connecteur en deux parties, vue d'ensemble de disposition

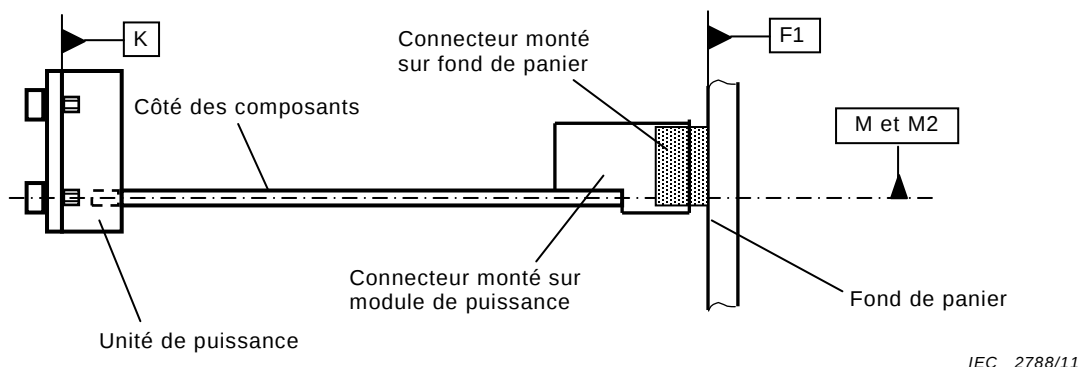


Figure 15 – Connecteur en deux parties, vue d'ensemble de disposition – Vue de dessus

6.3.2 Connecteur en deux parties, dimensions de carte imprimée, 2 U

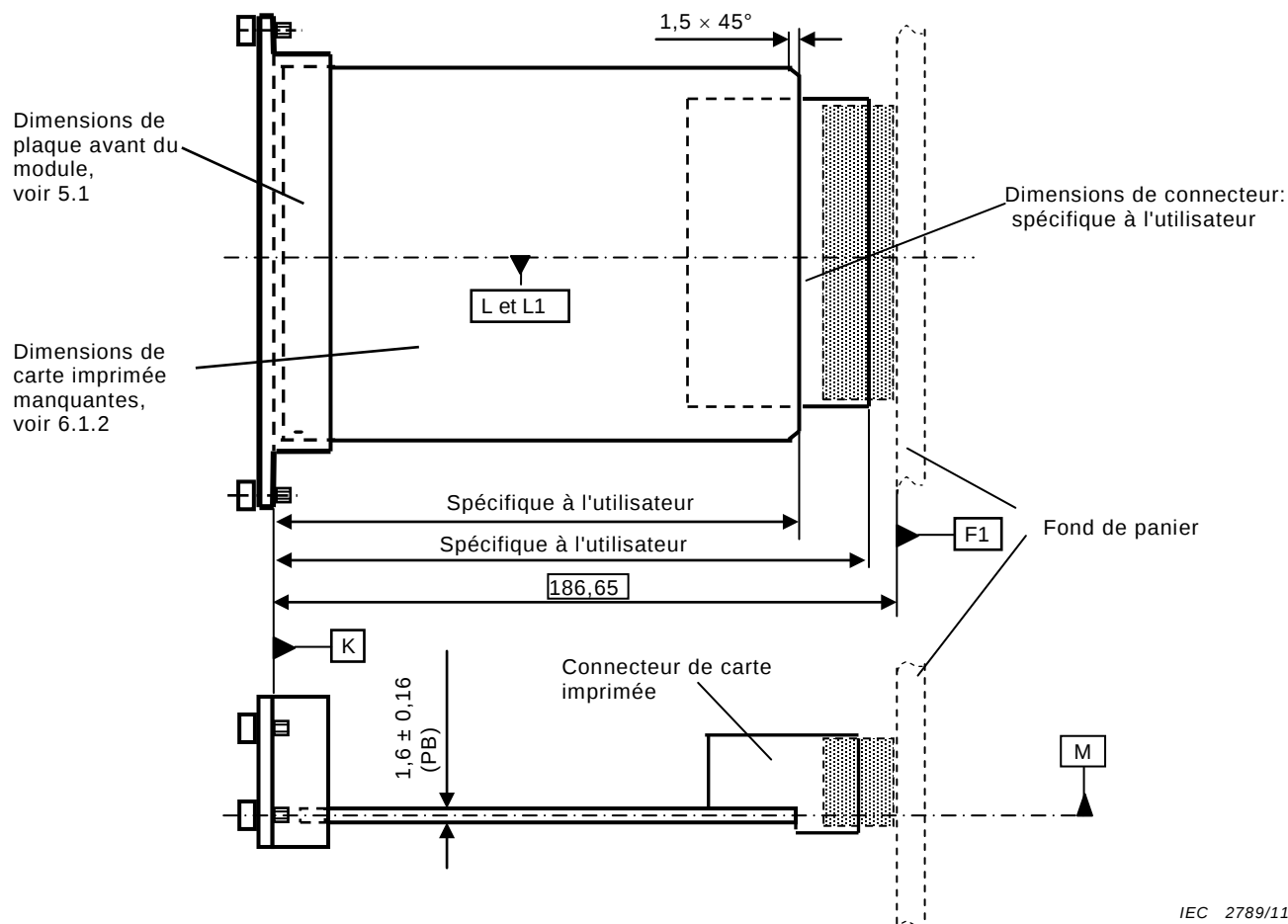


Figure 16 – Connecteur en deux parties, dimensions, 2 U

6.3.3 Connecteur en deux parties, connecteur installé dans un fond de panier, 2 U

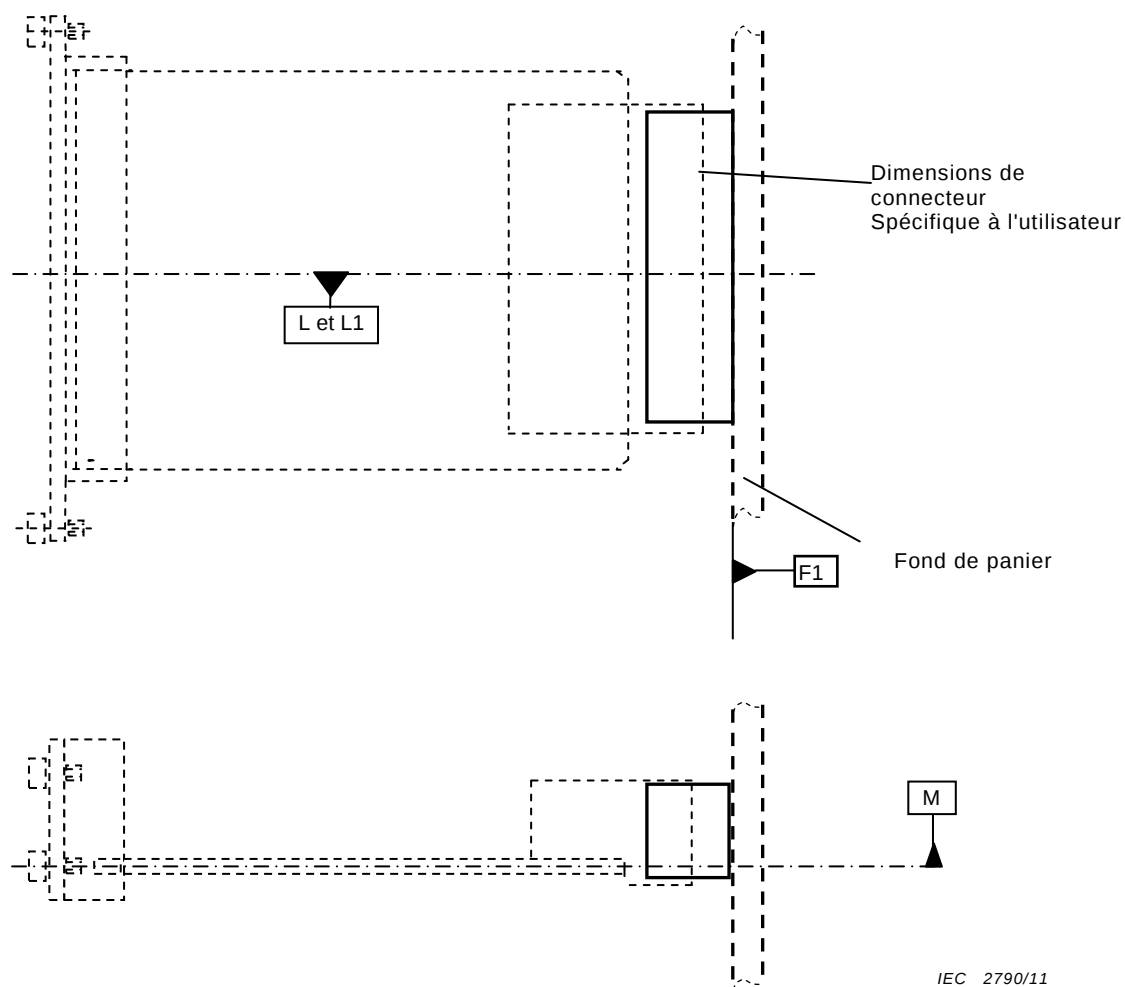


Figure 17 – Connecteur en deux parties, dimensions de connecteur installé dans un fond de panier, 2 U

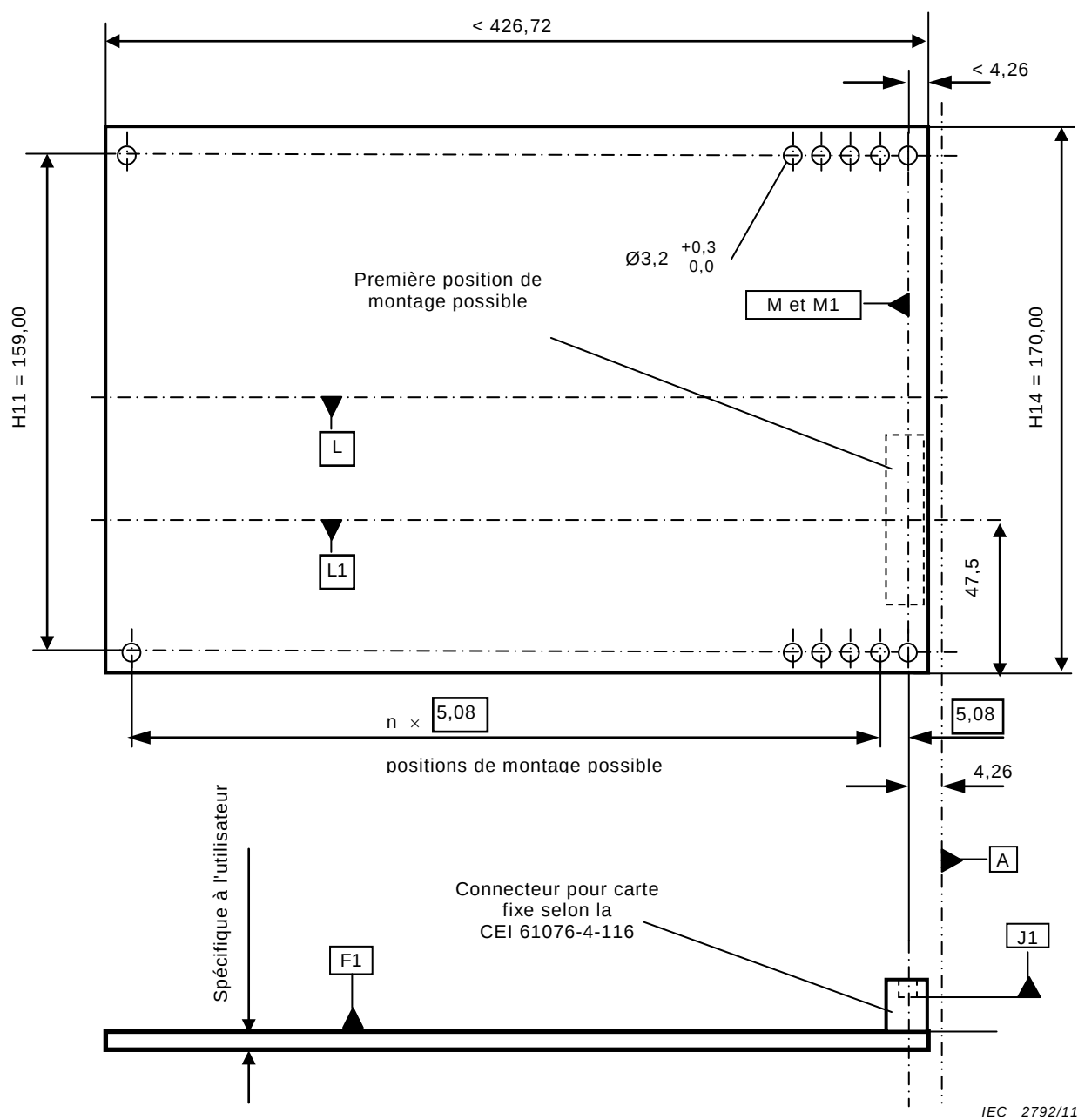


Figure 18b – Dimensions des fonds de panier 4U

Figure 18 – Dimensions des fonds de panier

8 Bacs et blocs enfichables avec dispositions pour blindage électromagnétique (CEM)

8.1 Généralités

Les spécifications des dimensions des dispositions pour blindage électromagnétique pour les bacs et les blocs enfichables associés sont limitées aux interfaces des bacs et des blocs enfichables. Les dimensions de base sont conformes à l'Article 4 et à l'Article 5 de la présente Norme. Seules les dimensions étendues des interfaces de blindage sont traitées par cet Article. Il convient de choisir les matériaux des interfaces de blindage pour leurs propriétés de contact appropriées.

8.2 Dispositions CEM des bacs

Les dimensions des blocs enfichables correspondants sont présentées en 5.1.

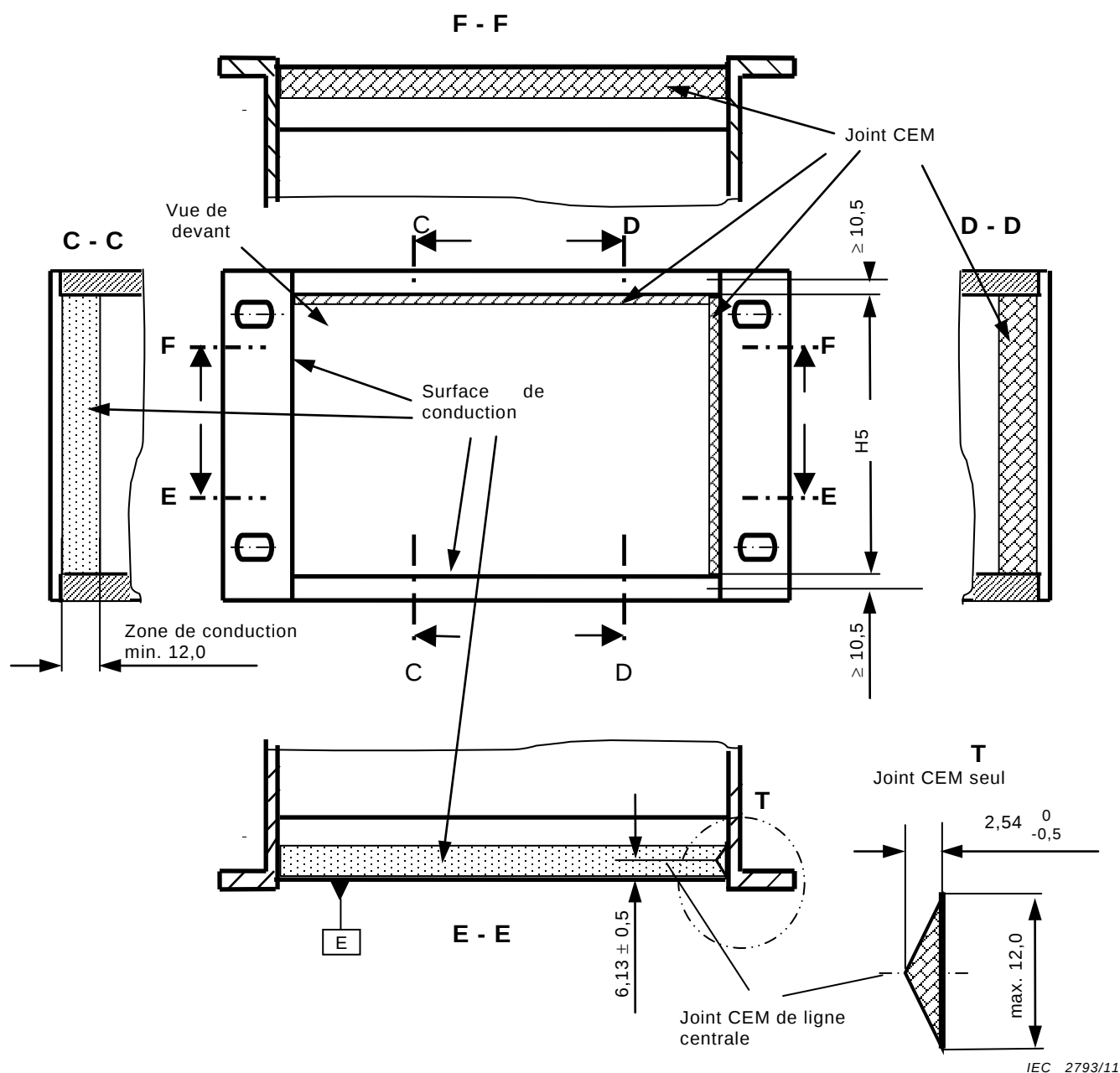


Figure 19 – Dimensions CEM des bacs

IEC 2793/11

8.3 Dispositions CEM des panneaux de remplissage et des blocs enfichables

Les dimensions de base sont conformes à l'Article 5 de la présente Norme. Seules les dimensions étendues des interfaces de blindage sont présentées.

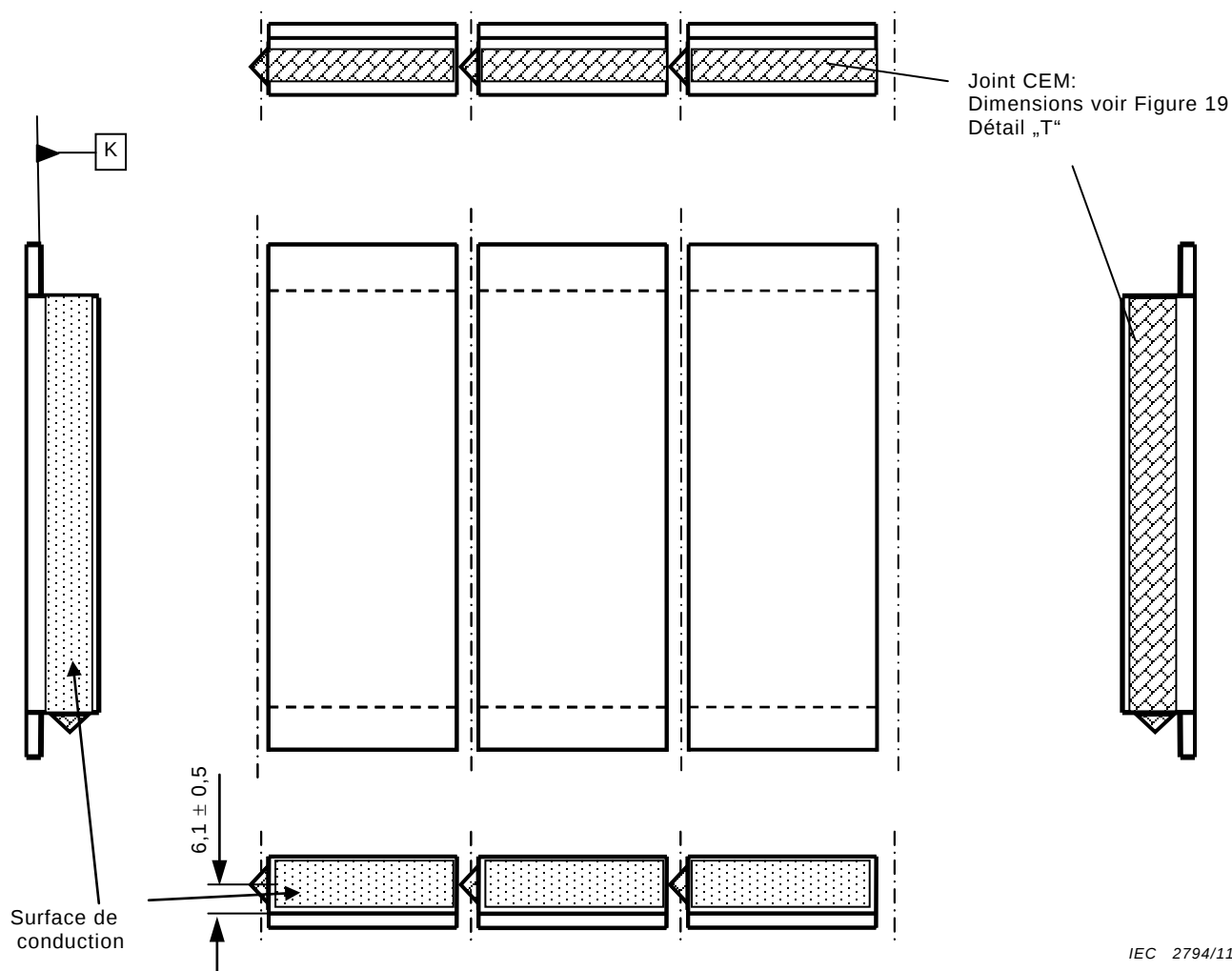


Figure 20 – Dimensions CEM des blocs enfichables

9 Dispositions pour décharges électrostatiques (ESD) pour bacs et blocs enfichables

9.1 Généralités

Cet Article spécifie les dimensions d'interface pour un contact de décharge électrostatique mis en œuvre dans le rail de guidage et la bande de conduction correspondante sur la carte imprimée d'un bloc enfichable.

Les bandes de conduction sur la carte imprimée sont représentées pour deux exigences d'application: avec une connexion permanente et la dimension de la profondeur de la carte ou avec une interruption avant d'engager complètement la carte dans le connecteur.

9.2 Dispositions ESD des bacs

Le contact ESD doit être connecté au montant horizontal du bac et être fixé de manière élastique dans la zone du rail de guidage déterminée. Le contact ESD doit être capable de connecter la carte insérée des deux côtés.

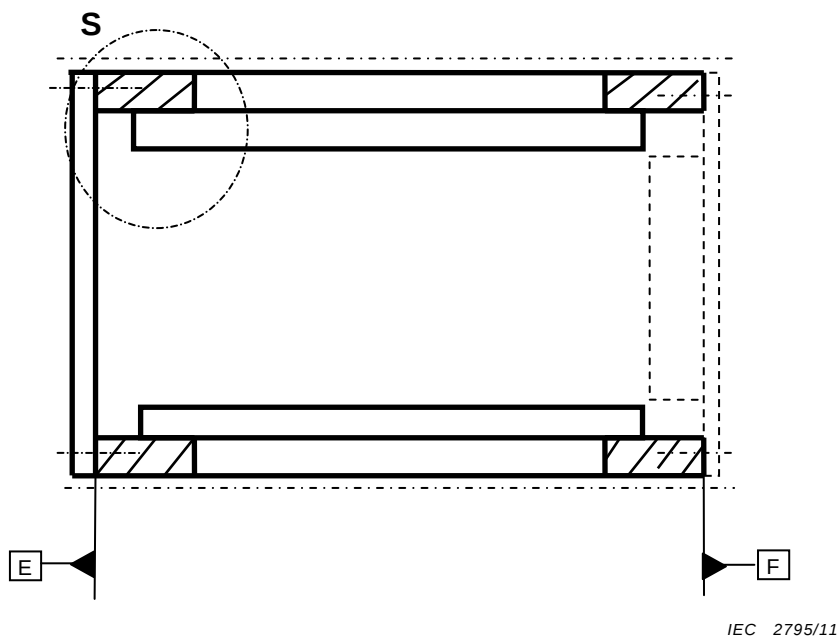


Figure 21a – Dispositions ESD des bacs, vue d'ensemble

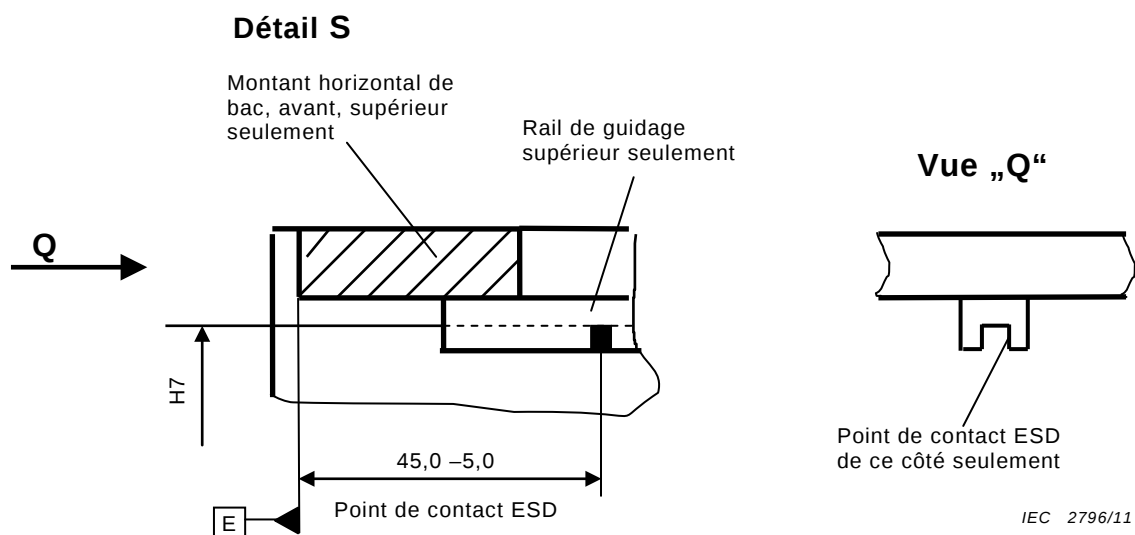
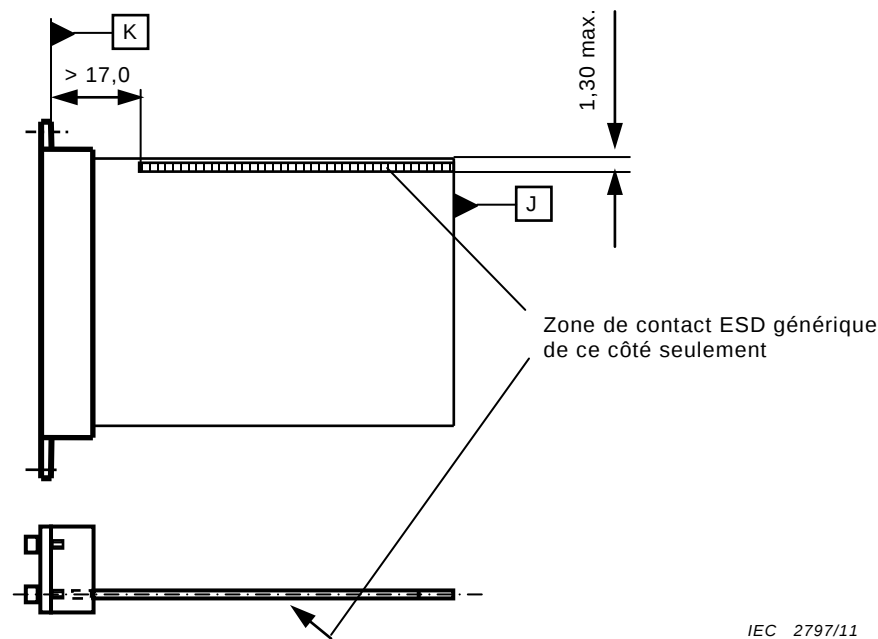


Figure 21b – Dispositions ESD des bacs, rail de guidage

Figure 21 – Dispositions ESD des bacs

9.3 Dispositions ESD des blocs enfichables, montage avant

Dimensions manquantes, voir Figure 6.



IEC 2797/11

Figure 22 – Dispositions ESD des blocs enfichables

Tableau 1 – Dimensions en hauteur

	Unités de hauteur	
	3 U	4 U
H1 ± 0,4 ^a	132,55	177,00
H2 ± 0,4	57,15	101,60
H3 ± 0,4	37,70	37,70
H4 ± 0,4	-	-
H5 ± 0,4	76,20	151,20
H6 ± 0,2	84,00	159,00
H7 ± 0,4	74,00	149,00
H8 ± 0,2	95,00	170,00
H9 ± 0,2	84,00	159,00
H10 ± 0,1	73,50	148,50
H11 ± 0,2	84,00	159,00
H12 ± 0,2	73,80	148,80
H13 ± 0,1	65,00	65,00
H14 0 / -1,0	95,00	170,00
^a La dimension en hauteur H 1 sert de référence si la conception des bacs est prévue pour être adaptée à la hauteur disponible de n × U. Des dimensions en hauteur inférieures peuvent être utilisées selon le cas, pour la stabilité ou pour des exigences de conceptions spéciales (H1min = H14).		

Tableau 2 – Dimensions en profondeur

D 1 $\pm$ 0,3	185,85
D 2	162,00
D 3	156,80
D 4 $\leq$	153,50
D 5 $\pm$ 0,4	180,85
D 6 $\leq$	157,75
RD 1 $\pm$ 0,3	185,85

10 Nomenclature

Hauteur

- U: Unité de hauteur de coordination de 44,45 mm (1,75 pouces). Voir CEI 60297-3-100.
- H1: Hauteurs de bacs (égales à la dimension E de la CEI 60297-3-100).
- H2: Positions des trous de montage entre bacs et baies ou bâtis (égales aux dimensions Y / Z de la CEI 60297-3-100).
- H3: Positions des trous de montage entre bacs et baies ou bâtis (égales aux dimensions A de la CEI 60297-3-100).
- H4: Positions des trous de montage entre bacs et baies ou bâtis (égales aux dimensions Y / Z de la CEI 60297-3-100).
- H5: Ouverture verticale des bacs pour blocs enfichables.
- H6: Entre-axe de montage pour panneaux et blocs enfichables, avant et arrière.
- H7: Hauteur de guidage de cartes imprimées.
- H8: Hauteur de panneau des blocs enfichables.
- H9: Entre-axe de montage des panneaux des blocs enfichables verticaux.
- H10: Hauteur de carte imprimée dans la hauteur de guidage des bacs.
- H11: Entre-axe de montage pour fond de panier.
- H12: Dimension en hauteur de corps de panneau avant/arrière.
- H13: Hauteur de carte imprimée dans la hauteur de guidage des connecteurs.
- H14: Dimension en hauteur des fonds de panier.

Largeur

- HP: L'ouverture des bacs est théoriquement divisée en N x pas horizontal (HP) de 5,08 mm.
La largeur du panneau avant des blocs enfichables est divisée en N x pas horizontal de 5,08 mm.

Profondeur

- D1: Dimension des bacs entre le plan de fixation avant et le plan de fixation de fond de panier.
- D2: Dimension entre le plan de fixation de fond de panier et le rail de guidage supérieur.
- D3: Dimension entre le plan de fixation de fond de panier et le rail de guidage inférieur.
- D4: Dimension de zone interdite de carte imprimée – côté inférieur, utilisant un connecteur de bord de carte.

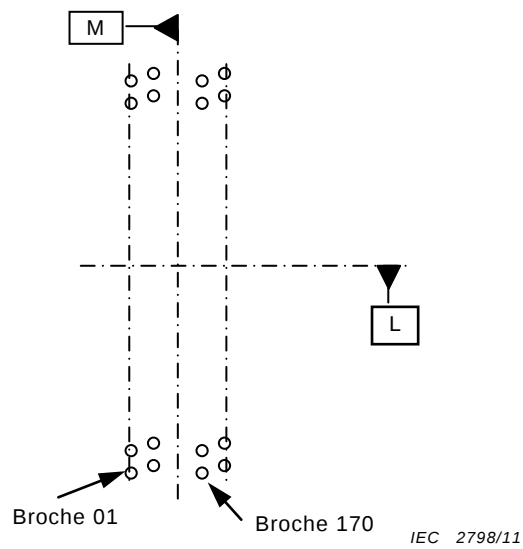
- D5: Dimension des blocs enfichables entre l'arrière d'une plaque avant et utilisant un connecteur de bord de carte.
- D6: Dimension de zone interdite de carte imprimée – côté supérieur, utilisant un connecteur de bord de carte.
- RD1: Dimension des bacs entre le plan de fixation arrière et le plan de fixation de fond de panier arrière.

Plan de référence (donné dans les cases carrées)

- A: Bac, première ligne de pas
- B: Bac, dernière ligne de pas
- C: Bac, paroi intérieure gauche
- D: Bac, paroi intérieure droite
- E: Bac, plan de fixation avant
- F: Bac, plan de fixation de fond de panier
- F1: Le bas du connecteur touche F sur le fond de panier
- G: Rail de guidage, surface d'interface avec carte imprimée
- G1: Module carte imprimée, surface d'interface avec rail de guidage
- J: Bloc enfichable, bord avant de carte imprimée
- J1: Position de fond du module carte imprimée ou connecteur pour carte libre dans connecteur pour carte fixe
- J2: Position de fond du module carte imprimée dans connecteur pour carte libre
- J3: Connecteur pour carte libre, bord avant
- K: Bloc enfichable, arrière de plaque avant
- L: Ligne centrale, module carte imprimée et bac
- L1: Ligne centrale de connecteur
- M: Ligne centrale d'épaisseur du module carte imprimée
- M1: Ligne centrale de cavité de connecteur
- M2: Ligne centrale de rail de guidage
- N: Bac, plan de fixation arrière
- O: Bac, plan de fixation de fond de panier arrière

Annexe A (informative)

Diagramme des trous de connecteurs sur le fond de panier



**Figure A.1 – Emplacement des broches de connecteur
selon la CEI 61076-4-116, vue avant**

Annexe B (informative)

Mise en œuvre de blocs enfichables à montage arrière

B.1 Dimensions en profondeur des bacs

B.1.1 Bac de type 1

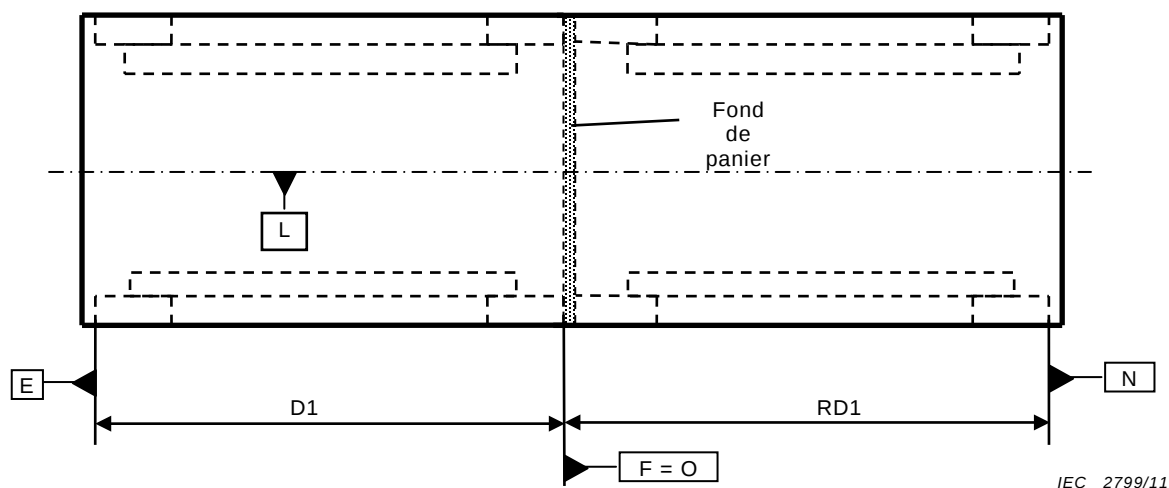


Figure B.1 – Dimensions en profondeur d'un bac de type 1, vue latérale

B.1.2 Bac de type 2

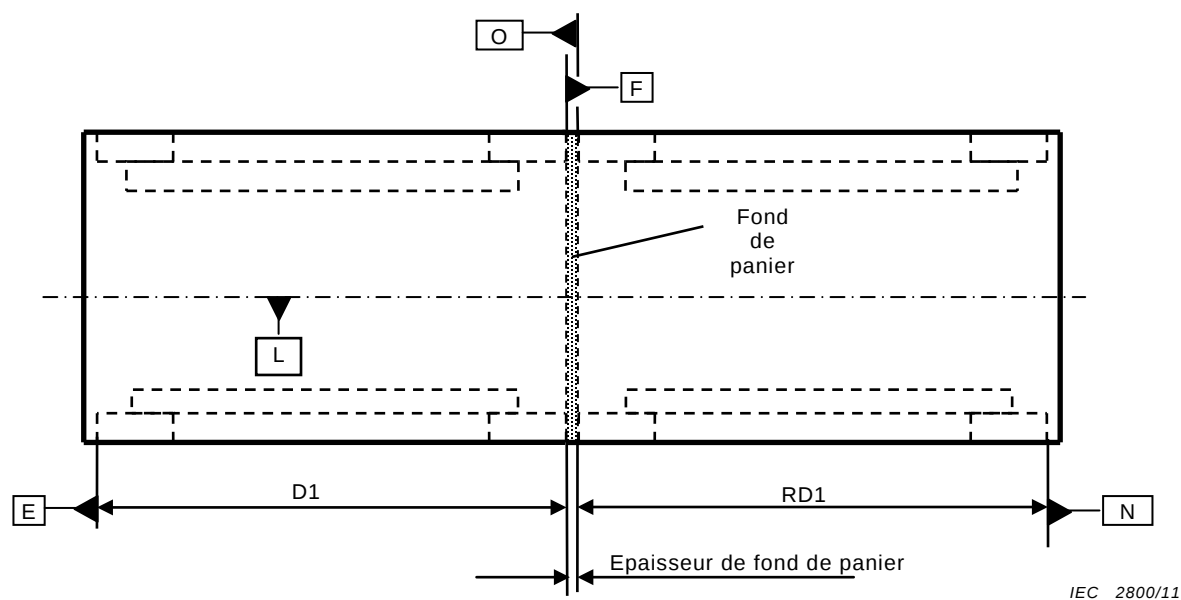


Figure B.2 – Dimensions en profondeur d'un bac de type 2, vue latérale

B.1.3 Bac de type 3

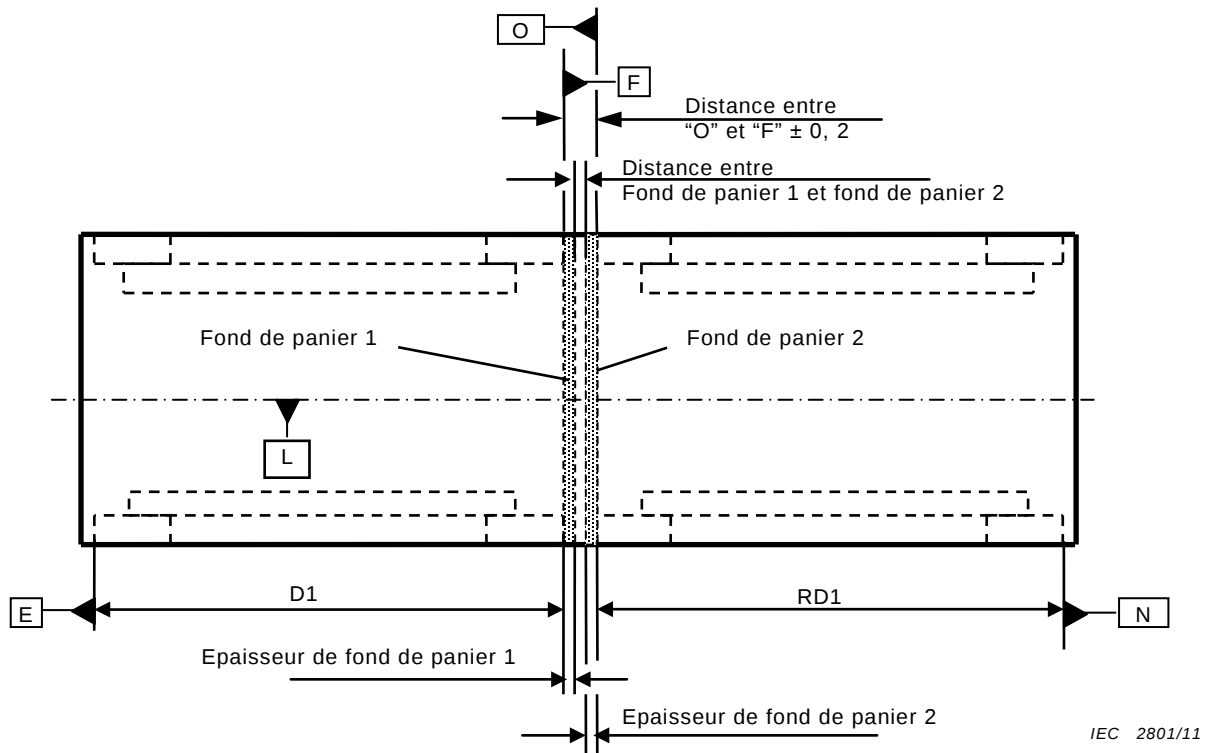


Figure B.3 – Dimensions en profondeur d'un bac de type 3, vue latérale

Annexe C (informative)

Fonction de remplacement à chaud

Les informations détaillées sont présentées dans les spécifications PICMG-AMC.0 et PICMG-MTCA.0.

Annexe D (informative)

Dimensions d'interface de mécanisme de verrouillage des bacs pour exigences renforcées

Les informations détaillées sont présentées dans la spécification PICMG-MTCA.1 section 2.5.2.2: Mécanisme de verrouillage des bacs obligatoire.

Annexe E (informative)

Dimension d'interface de contact ESD des bacs

Les informations détaillées sont présentées dans la spécification PICMG-MTCA.0, Figure 2-42; vue Y.

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch